

業 務

概覽

我們是一家全球領先的數據通訊領域PCB解決方案提供商。我們開發、製造並銷售各類PCB產品。我們的產品為數據通訊及智能汽車應用領域的關鍵元器件。人工智能的爆發推動數據中心需求蓬勃發展，特別是在高性能計算與數據互連應用領域，已成為驅動我們業績增長的核心引擎。此外，汽車電動化、智能化及網聯化的快速發展也為我們在智能汽車領域實現長期增長注入動力。下圖展示了我們的業務亮點：

市場地位

全球領先地位

PCB排名第六⁽¹⁾
數據通訊用PCB排名第一⁽¹⁾⁽²⁾
數據中心PCB排名第一⁽¹⁾⁽²⁾
多層PCB排名第一⁽¹⁾

增長態勢

財務表現

近七年收入複合年增長率 **19.3%** 近七年權益收益率 **高於15%**

發展動能

2026年第一季度
PCB收入增長 **52.5%** 2024年至2025年
權益收益率增長 **23.9% ➡ 28.4%**

技術

掌握**100層以上PCB**板技術
10階HDI技術已通過驗證
44層「N+N」結構PCB量產⁽³⁾
54層「N+M」結構PCB量產⁽³⁾
功率半導體嵌入式PCB**唯一**大批量量產⁽⁵⁾

終端客戶

全球前五大通訊設備企業**全覆蓋**⁽⁴⁾
全球前五大AI算力基礎設施上市企業**全覆蓋**⁽⁴⁾
全球前五大汽車一級供應商覆蓋**四家**⁽⁴⁾
與若干主要終端客戶平均合作年限**超20年**

附註：

- (1) 根據灼識諮詢的資料，按2025年收入計；數據通訊、數據中心用PBC以及多層PCB為全球PCB市場的細分市場，分別佔2025年全球PCB市場的37.3%、23.2%及38.9%。
- (2) 數據通訊應用領域包括高速網絡交換機和路由器、AI服務器及HPC、通用服務器以及無線通訊網絡等；根據灼識諮詢的資料，數據中心應用領域包括高速網絡交換機及路由器、AI服務器及HPC以及通用服務器。
- (3) 「N+N」、「N+M」分別指多層板PCB的對稱結構及非對稱結構；請參閱「技術詞彙表」。
- (4) 根據灼識諮詢的資料，就通訊設備公司而言，按2025年通訊設備銷售收入計；就AI算力基礎設施公司而言，按2025年的收入計；就汽車一級供應商而言，按2025年收入計。
- (5) 根據灼識諮詢的資料。

業 務

我們的產品

我們高性能、高信賴性的PCB產品⁽¹⁾



多元應用領域

數據通訊



高速網絡交換機
及路由器



AI服務器及HPC



通用服務器



無線通訊網絡

智能汽車



工業控制



附註：

(1) 圖片僅作說明之用，並非表示特定的層數。

我們深耕高速網絡交換機及路由器、AI服務器及HPC、通用服務器、無線通訊網絡及智能汽車等具備技術壁壘的領域的PCB產品。在數據通訊領域，我們的產品廣泛應用於超大規模數據中心、雲服務提供商數據中心、企業通訊網絡、本地網絡及園區網絡等場景。在智能汽車領域，我們的產品應用於自動駕駛域控制器、ADAS、智能座艙、以及電池、電機和電控系統等關鍵系統。以下載列我們主要應用領域的詳情：

高速網絡交換機及路由器。我們的產品滿足AI算力集群、數據中心、雲計算、邊緣計算及超大規模運算場景下對高帶寬與超低時延數據交換的要求。我們提供用於背板、線卡及交換板的超大尺寸、高層數及非對稱結構的高多層板產品。我們是400G/800G高速網絡交換機的核心PCB供應商。目前，我們已實現1.6T交換機用PCB產品的量產並開始出貨，且正推動3.2T及下一代交換機用PCB的研發及產能準備。

業 務

AI服務器及HPC。為滿足對高功耗、大電流及低時延的嚴苛要求，我們已建立包括超低損耗材料應用、信號完整性設計與電源完整性優化在內的關鍵技術體系。我們提供用於高頻高速工作環境的高多層PCB及超大尺寸高層HDI產品。我們的產品已廣泛應用於AI服務器及HPC的關鍵、高價值部件，例如服務器主板、OAM、UBB、DPU、PCIe／超大規模交換機及ASIC主板。

通用服務器。為滿足對長期穩定性及跨平台兼容性的要求，我們的製造流程導入可靠性驗證及標準化制程，生產具備熱穩定性及電氣信號完整性的高多層PCB產品。我們的產品應用於通用服務器主板、存儲控制模塊、智慧網卡及電源管理單元等關鍵部件，得以構建高效、可靠的數據計算基礎設施。

無線通訊網絡。為滿足對射頻信號傳輸質量與可靠性的需求，我們已建立高頻高速材料選型與應用能力，並結合射頻電路設計與信號完整性優化技術，開發出面向無線通訊網絡的PCB解決方案。我們能夠為包括無線接入單元、信號傳輸、網絡管理控制與邊緣計算節點在內的多類場景提供高性能及高信賴性的PCB產品，其廣泛應用於通訊基站、天線、濾波器及功率放大器等關鍵通訊設備。

智能汽車。為滿足車規級標準對高速運算、高壓平台、散熱及抗電磁干擾（「EMI」）防護的需求，我們依託專業知識及零DPPM製造理念提供高性能及高信賴性的PCB解決方案。我們的多層PCB、HDI PCB及功率半導體嵌入式PCB覆蓋三電系統、駕駛域控制器、智能座艙等關鍵領域。我們用於汽車智能化及電氣化系統的PCB主要用於L2+自動化駕駛功能的智能汽車。

工業控制。為滿足工業場景對PCB壽命及環境適應性的要求，我們為客戶提供高性能和高信賴性多層板PCB產品，其廣泛應用於高端工業自動化設備等嚴苛工業控制場景。

我們的市場機遇

根據灼識諮詢的資料，按收入計，全球PCB市場預計於2030年達致1,233億美元，於2025年至2030年期間複合年增長率約為7.7%。科技創新正持續推動全球PCB市場增長。驅動增長的主要關鍵因素包括：(i)數據中心等人工智能基礎設施的大規模建設，推動算力生成與數據互連需求增長；及(ii)汽車電動化及智能化等技術進步，推動車聯網與自動駕駛應用的發展。

業 務

人工智能基礎設施成為PCB需求的核心驅動力

數據中心的建設是推動PCB需求增長的關鍵動力。根據灼識諮詢的資料，按收入計，預計到2030年，全球數據中心PCB市場規模將達313億美元，2025年至2030年的複合年增長率為9.6%。具備高速傳輸、高密互連及高通流能力的PCB是數據中心實現互連信號傳輸與系統集成的關鍵部件，能有效應對數據中心對極速數據傳輸、高帶寬多芯片互聯、穩定供電與高效散熱等方面的需求。隨著人工智能技術融入數據中心、雲計算、工業自動化及智能終端等應用場景，通訊網絡的傳輸速率、帶寬容量需求攀升，助力高性能與高信賴性PCB市場擴容。由於我們深耕數據通訊領域，我們有信心實現可持續增長。

汽車電動化及智能化推動PCB價值躍遷及市場擴容

根據灼識諮詢的資料，汽車電動化及智能化推動單車PCB需求顯著增長。根據灼識諮詢的資料，相較於傳統汽車，智能汽車單車PCB價值量增長約6至8倍，主要受益於ADAS、自動駕駛域控制器、智能座艙及汽車控制模塊對具備車規級高速運算、高壓平台、高效散熱及抗電磁干擾能力的高性能與高信賴性PCB需求增長。

根據灼識諮詢的資料，至2030年，全球汽車PCB市場規模將增至119億美元，2025年至2030年的複合年增長率約為4.2%。其中，L2+自動駕駛PCB是增速最快的細分領域之一，預計2030年市場規模約為54億美元，2025年至2030年的複合年增長率約為11.5%。隨著智能汽車行業繼續演進，市場對車規級多層板、HDI及功率半導體嵌入式PCB等產品的需求將持續提升，其與我們智能汽車產品的佈局高度契合。

我們的發展根基

我們把握增長機遇，並透過交付技術要求日益複雜的應用所需的高效能、高可靠性解決方案，在市場中脫穎而出。我們的成功與持續增長主要基於三大發展基座：

具洞察力及遠見的研發方針

基於對行業前沿趨勢與未來市場需求的持續跟蹤與分析，我們制定技術路徑，專注於高多層、高頻高速、高密度互連及高通流等PCB關鍵核心技術，並已建立全面的技術能力，使我們能夠應對行業變革，保持競爭優勢。

業 務

品質把控

我們將智能製造融入我們的生產體系，確保產品保持卓越品質。在PCB製造過程中，我們執行從原材料檢驗到成品測試的質量監控，通過檢測設備與實時工藝監控系統，保持產品的穩定性與一致性，使我們能夠滿足全球頭部且多元化客戶群體的質量要求。

深度客戶協同

我們通過長期合作，構建了全球終端客戶網絡與市場聲譽。我們以產品全流程開發模式為核心，涵蓋從產品定義、合作開發，到量產的完整流程，將我們的產品融入了全球數據通訊及智能汽車等領域頭部企業群體的迭代進程，建立了穩固的客戶基礎。我們與五家全球終端客戶保持了20年或以上的長期合作。

我們的綠色發展

我們通過建立涵蓋研發、製造以致日常運營等各個環節的綠色管理體系，踐行以節能減碳為核心的綠色發展理念。我們制定明確的溫室氣體排放管控措施及長期碳減排目標，並委託獨立第三方機構開展定期檢查。我們在可持續發展方面的關鍵績效指標均超越了中國最嚴格的國家標準—1級清潔生產標準，包括單位產品耗電量、單位產品耗水量、工業用水回收率以及銅回收率。我們獲得了國際水資源管理聯盟（「AWS」）國際水資源管理標準的最高級別（白金級）認證，並在水資源安全及氣候變遷行動方面獲得碳披露計劃的認可。

我們的財務表現

我們成功把握市場機遇，推動收入、毛利及淨利潤實現持續增長。於2023年、2024年、2025年以及截至2025年及2026年3月31日止三個月：(i)我們的收入分別為人民幣8,938.3百萬元、人民幣13,341.5百萬元、人民幣18,945.2百萬元、人民幣4,037.6百萬元及人民幣6,214.2百萬元，(ii)我們的毛利率分別為28.4%、31.7%、33.8%、31.3%及34.8%及(iii)我們歸屬於本公司擁有人的淨利潤達人民幣1,512.5百萬元、人民幣2,587.2百萬元、人民幣3,822.3百萬元、人民幣762.5百萬元及人民幣1,242.1百萬元；我們的淨利率分別為16.9%、19.4%、20.2%、18.9%及20.0%。

業 務

我們的優勢

聚焦PCB主業，堅持精益求精，前瞻佈局把握產業升級

我們是全球領先的高性能、高信賴性的PCB解決方案提供商。自創立以來，我們秉持聚焦PCB主業的運營戰略。我們憑藉發展藍圖及業務戰略把握市場機遇，不斷成長進步。1992年，作為首批從中國台灣到中國內地投資的PCB製造商之一，我們把握機遇，率先於昆山建設生產基地，為大規模製造佈局奠定了堅實的基礎。1998年，我們開發具技術壁壘及增長潛力的通訊背板產品，奠定了我們在高層、厚板、超大尺寸PCB領域的技術基礎。2000年，我們發現汽車行業的機會，並開發用於汽車應用的PCB產品。2007年，我們退出消費電子市場，聚焦具增長潛力的數據通訊及智能汽車領域，精準把握了全球通訊基礎設施建設的產業機遇。我們始終致力於高性能及高信賴性PCB產品的創新與技術迭代，持續鞏固並提升核心競爭力，與AI領域頭部終端客戶協同，推動我們的PCB產品在層數、尺寸與電路開發上的突破，在AI浪潮中佔據先發優勢。

我們深耕PCB領域所積澱的深厚技術底蘊與產業經驗，與數據中心市場需求形成契合。憑藉在高層數PCB、高速材料應用與高精密工藝的技術儲備，我們滿足了數據中心及智能汽車對PCB高性能、高信賴性的嚴格要求，並成功轉換為服務客戶的核心競爭優勢，鞏固了我們在業界的地位，並在多變的市場下實現長期穩健增長。

立足多元的客戶生態，和全球頭部客戶群體長期合作

我們和數據通訊及智能汽車等領域頭部客戶建立起跨越市場與技術周期，穩定持久的夥伴關係，和客戶共同成長。

長期合作：穩定持久的戰略合作關係

我們建立穩定共贏的戰略合作夥伴關係。早期，我們主要服務於通訊及汽車行業終端客戶。隨著技術趨勢與市場格局的演變，我們支持客戶在人工智能與智能汽車領域的發展迭代。現今，我們已與全球領先的人工智能服務器製造商、雲服務提供商及智能汽車企業建立戰略合作。我們和終端客戶的合作從當前產品技術對接延伸至未來技術的聯合開發，使我們得以將技術路徑與產能規劃和客戶的目標保持一致。我們與五家主要終端客戶的合作時間達20年或以上。例如，逾25年前，我們首次與一家全球頂尖數據通訊設備商建立合作，從背板產品起步，合作領域逐漸拓展至高速網絡交換

業 務

機及路由器。近25年前，我們開始與一家全球領先的智能汽車Tier 1供應商開展合作，我們作為其核心PCB供應商之一，持續為其提供車規級零DPPM產品與技術支持。基於產品表現與協同創新能力，我們已融入客戶的長期發展體系，於2023年、2024年及2025年獲得超過十家行業頭部客戶頒發的年度最佳全球供應鏈運營商、「年度傑出合作夥伴」及「傑出品質供應商」等榮譽。

廣度覆蓋：多元及國際化的客戶網絡

根據灼識諮詢的資料，我們的終端客戶涵蓋全球前五大通訊設備公司、全球前五大AI算力基礎設施上市公司及全球前五大汽車Tier 1供應商中的四家。在數據通訊領域，我們的核心終端客戶包括全球算力解決方案提供商、大型雲服務提供商、主流網絡與數據中心基礎設施供應商。在智能汽車領域，我們已覆蓋全球汽車Tier 1供應商及頭部新能源汽車品牌。此外，我們的大部分收入來源於境外市場，我們為不同終端客戶提供服務，促進其技術和產品升級。

領先技術奠定高性能、高信賴性的產品競爭力

我們高性能、高信賴性的PCB產品核心競爭力植根於技術積累與協同創新文化之中。我們在研發團隊帶領下，通過跨部門協同開發流程，全面推進產品從概念設計到穩定量產的轉化。我們與產業鏈的合作夥伴、大學及研究機構開展合作，推動產品性能提升、迭代創新及合併成本優化。此外，領先目前市場及客戶需求的研發是我們研發策略的關鍵要素。我們配置資源，在新興領域中開發基礎技術，有時早於客戶明確需求定義或提前啟動下一代產品的開發周期。

技術積淀打造差異化優勢

我們在PCB關鍵技術領域與工藝優化上已經取得重要進展：

高多層板技術。掌握生產100層以上PCB技術的能力，並實現54層以上高多層板的量產。我們的技術優勢包括N+N及N+M高多層板PCB的技術以及層間對準精度、壓合可靠性及阻抗控制一致性等能力。我們的技術已滿足先進數據通訊應用場景的要求，並正演進以匹配產品不斷增加的性能需求。

業 務

高頻高速材料及工藝。M9等級高速材料與常規FR-4材料的混壓工藝使我們能夠構建具備超低損耗特性的複合板材結構，滿足高速信號傳輸對介質特性的要求。我們已將高頻高速電路材料與工藝應用於400G/800G/1.6T高速網絡交換機的高性能及高信賴性PCB產品中，啟動了基於448 Gbps速率的3.2T及以上交換機用PCB材料和工藝佈局。

HDI技術。我們已實現七階HDI PCB的量產，通過採用HVLP4及以上級別低輪廓銅箔與精密Build-Up工藝，實現高密度層間互連，提升信號傳輸速率和完整性。同時，我們對產品翹曲程度進行控制，以維持物理穩定性與可靠性。我們的11階HDI技術已經通過終端客戶驗證。

高通流技術。以銅基板與高熱穩定性材料為基礎，我們優化電源架構設計，實現高效電流傳輸與熱管理。我們的解決方案能夠滿足數據中心及汽車電源模塊對大電流承載的要求，為高功率應用場景提供穩定可靠的性能支持。

我們的核心技術經過適配並應用於多個不同領域。我們專有的用於設計驗證與優化的數字化平台助力研發活動的開展。該平台融合多年產品研發構建的仿真模型庫與技術數據庫，賦能研發團隊開展的數字化設計驗證與優化，不僅提升了研發效率，更縮短了新產品推出時間。我們能夠持續開發並提供我們客戶所要求的高性能、高信賴性PCB解決方案。

協同研發體系

我們聯合產業鏈上下游合作夥伴構建協同研發生態，將我們的創新投入與客戶的商業及技術需求、供應商的能力緊密相連。

客戶側。我們與數據通訊、智能汽車等領域核心終端客戶建立了協同的同步開發，全面參與概念定義到產品落地過程，助力其技術應用及產品設計。我們的研發團隊參與終端客戶產品概念形成的早期階段，使我們的PCB研發與彼等的技術需求一致。在後續產品開發過程中，我們的現場應用工程師與終端客戶保持溝通，提供技術支持並保障產品上市。這讓我們能洞察終端客戶的技術需求，在我們於彼等產品開發周期的早期聯合開發產品，讓我們強化我們穩固的供應鏈夥伴關係。

業 務

供應商側。我們與設備供應商開展聯合研發，持續推動高性能PCB材料、專用設備與新工藝的應用。我們加強與供應商的合作關係，由採購轉化為合作創新，我們參與彼等的設備設計及優化，以與我們的關鍵製程要求一致。我們的研發團隊與該等供應商合作，以提升設備的功能與性能，使其適配我們的生產要求，繼而實現更精密及更穩定的工藝。

質量管理、綠色智造打造高端產品品質

我們維持覆蓋產品全生命周期的質量管理體系，將綠色製造與智能製造原則融入我們的生產及運營流程，在提升產品性能與可靠性的同時，構建可持續製造能力。這一體系使我們長期在生產精度、質量一致性與綠色可持續發展方面保持領先地位。

卓越品質鑄就高端產品長期競爭力

我們憑藉在技術水平與專業能力上的不斷精進，得以及時向客戶交付滿足彼等需要的產品與服務，且我們為此建立了貫穿產品生命周期的質量管理體系，奠定我們提供差異化PCB解決方案的根基。我們建立供應鏈管理體系，與全球領先覆銅板供應商保持長期合作。我們實施涵蓋資質審核、實地考察、樣品測試以及環境、健康及安全管理審核的供應商准入機制。我們亦建立包含質量監測和定期評核的多維評價體系，可以全面評估供應商的技術能力、質量穩定性、產品交付以及ESG合規。依託與核心供應商超20年的合作，我們構建了覆蓋全球多地的供應鏈佈局，提供堅實可靠的原材料保障。

在產品研發初期，我們的品質團隊介入，通過策劃與風險識別，為客戶提供即時可用的優質解決方案。在製造時，我們執行標準化作業流程，通過配備檢測設備與實時監控系統，推進自動化與智能化品質監控系統建設。通過日常管理標準，對產品品質提出要求並持續優化。

我們的高速網絡交換機、路由器及服務器用高多層PCB實現高平均生產良率。我們建立了質量追溯與改進機制，通過質量評審和客戶反饋分析，在產品技術複雜度有所提升的背景下，為高產品信賴度提供體系化保障。憑藉產品品質，我們贏得了全球頭部客戶群體的長期信賴。

業 務

綠色智造打造可持續的先進生產體系

我們提升智能製造能力。我們通過打造智能化產線，建設數據接口集成平台，協調各生產流程；構建覆蓋生產設備與檢測設備的統一通訊架構，確保製造數據的實時穩定採集與傳輸。我們部署高速網絡，保障數據高效流轉。同時，我們通過專有物聯網軟件將AI視覺檢測系統、機械手臂及環境能源監測單元連接起來，實現遠程監控與實時設備控制。我們的工廠根據需求動態調整生產流程，靈活適配多樣化任務，提升了生產資源的利用效率與市場響應速度。我們有集數據採集、AI分析、自主優化與智能預警於一體的專有閉環智能化生產體系。

我們積極踐行綠色智造理念，致力推進資源節約型和環境友好型企業建設。我們的生產基地配套建設了環保設施，可實現廢水處理、水資源及生產廢棄物循環利用以及排放物控制。我們的環境管理團隊對不同污染物實施管控措施。我們取得了ISO 14001環境管理體系及ISO 50001能源管理體系認證等國際權威認證。我們亦獲得了AWS國際水資源管理標準最高級別（白金級）認證，並在水資源安全領導力及氣候變遷行動方面獲得碳披露計劃的認可。我們的昆山滬士電子生產基地及黃石生產基地已獲評定為國家級綠色工廠，而昆山滬利微電生產基地獲評為省級綠色工廠。

資深穩定的專業管理團隊是我們長期發展進步的重要保障

我們的管理團隊擁有逾三十年PCB行業積淀，具備行業專長與持續的領導力。創始人吳禮淦及陳梅芳夫婦作為中國台灣地區PCB行業早期開拓者，親歷了中國台灣地區PCB產業從初期承接國際製造轉移到確立全球領先地位的完整過程，對技術路線與市場變遷具備深刻理解，以堅定的實業家精神與國際視野引領我們實現跨越式發展，與全球客戶共享成果。

我們的管理團隊秉持創始人勤勉守正、恪守誠信、專注技術及勇於開拓的精神，踐行技術驅動發展的理念，引領公司在高性能及高信賴性PCB領域持續作出技術革新，並積極推動全球產能佈局的深化與拓展，將我們的競爭優勢提升至新的高度。我們的核心管理團隊及經營骨幹具備技術背景，形成了以技術為核心的文化，奠定了「技術優先、品質為本、客戶共贏」的戰略基礎。同時，我們的核心管理團隊平均司齡約達25年、核心技術骨幹平均司齡超10年。

業 務

在人才培養方面，我們建立了以勝任力為導向的個性化培養體系，使個人與其職務相配。在團隊建設方面，我們擴充人才隊伍，形成了老中青結合、專業共識高度統一的梯隊結構。我們的文化塑造了實事求是的工作氛圍，並通過全面評估體系及激勵計劃獎勵績效表現，並將員工的利益與我們的成功相結合。

我們長期堅守「成長、長青、共利」經營理念，形成企業身份的基礎，為我們長遠發展指明戰略方向。在管理團隊的領導下，我們通過技術突破與市場開拓實現成長，敏捷洞察每一次佈局後的市場反饋，以此進一步驅動產品組合優化、技術方向、管理組織及長期競爭力。我們將持續推進技術革新、加強市場佈局、鞏固行業領先地位，在不斷演變的科技進步中持續發展。

我們的戰略

人工智能相關的新型應用加速釋放，推動行業快速增長。預期技術發展將推動電子產業鏈演進，PCB的產品形態、製造體系與供給格局將持續改變。我們致力於成為全球高性能及高信賴性的PCB解決方案的領軍者，把握行業高速發展變化帶來的機遇，持續構築差異化優勢。我們計劃推行以下戰略舉措：

技術為核心導向，構築長期市場競爭力

我們秉持「技術優先」的方針，致力於提升高性能及高信賴性PCB產品的研發能力，保證市場領先地位。

把握當下AI增長機遇，鞏固市場地位。面對AI基礎設施的建設加速與設備升級帶來的機遇，高多層板已成為下一代數據中心設備PCB技術的主流架構。我們將以高速網絡交換機及路由器、AI服務器等硬件為重點，加大對高性能PCB技術的研發投入。在800G高速網絡交換機規模化部署、1.6T網絡交換機啟動交付、3.2T網絡交換機技術研究佈局以及AI服務器迭代的背景下，我們旨在依託研發團隊，提升高端產品性能、引領技術演進，持續鞏固在數據中心領域高性能PCB市場的技術領先地位。

業 務

長期依託先進技術，塑造跨周期發展優勢。我們會將技術視為我們增長的根本驅動力。我們堅持獨立判斷與研發常規，在關鍵領域投入研發資源，推動技術與產品組合的迭代升級。面對數據通訊及智能汽車的持續發展變化，我們計劃投入高多層堆疊架構、高頻高速材料特性優化及高密度互連技術可靠性等基礎研究方向，增強技術儲備的廣度與深度。我們旨在保持對行業趨勢的洞察與快速響應，以在技術變革中率先把握方向。通過推進CoWoP等技術的研究及mSAP等先進工藝應用創新佔據先機，我們致力形成穿越市場周期的持續創新優勢。

規劃高端產能擴張升級，推動綠色智造體系建設

為把握AI浪潮與智能汽車發展帶來的增長機遇，我們計劃通過產能擴張和產線升級，積極構建領先的綠色智造體系，強化市場地位。我們規劃產能擴張與升級，重點在數據通訊及智能汽車領域高端產品的投入。我們計劃推動多區域的生產佈局，推進昆山、黃石、金壇及泰國等生產基地產能擴張建設，形成全球高端生產體系，把握行業需求快速增長的機遇，應對地緣政治風險。我們將以技術賦能生產，堅持綠色智造理念，通過自研設備軟件並引進人工智能技術等方式推動產線升級與精益製造，提升基地高端產品產能，降低產品單位能耗與碳排放強度，開展產品生命周期碳足跡評估，提升供應鏈ESG管理，把智能化與低碳融入生產。

加強價值鏈上下游合作、尋求戰略投資併購機會

我們將大力推進客戶合作、優化供應鏈合作與管理機制。我們將積極尋求產業鏈上下游投資併購機會，整合資源提升競爭力，共同助力業務增長。

加強下游多元終端客戶合作，引領新增長。我們將加強在數據通訊與智能汽車等戰略領域的業務佈局，服務領先終端客戶，而有關客戶一般包括該等領域的最終品牌擁有者或產品設計公司。依託技術實力與產品經驗，我們計劃為客戶提供高性能及高

業 務

信賴性的PCB解決方案。我們將堅持構建多元的終端客戶結構，覆蓋國內外更多高成長性終端客戶，增強抗風險能力，以維持業務增長與經營韌性。

加強與供應商的協作研發及加強我們的供應鏈。我們計劃加強與供應商合作，推進用於PCB製造的新材料開發及認證。我們計劃拓展並鞏固供應商群體。我們擬建設多區域供應商佈局以應對市場風險。

關注產業鏈投資機會以助力發展。我們擬圍繞主營業務，對PCB價值鏈目標企業進行投資與併購，以通過整合資源推動協同與價值提升，從而鞏固和增強競爭力。我們將在全球範圍內尋找與評估潛在目標。

培育人才團隊，促進未來增長

為構築技術壁壘、實現可持續發展，我們將堅持人才引領發展，集中內部人才培養，同時採取外部招聘，通過培養體系與激勵機制加速建設能支撐未來發展的團隊。

系統化培養體系。我們始終重視以勝任力為導向的培訓體系建設，為關鍵崗位員工設計學習規劃，並通過入職課程、通用課程、體系課程、專業技能、特殊工種培訓、安全培訓等訓練體系，快速提升員工的能力。我們計劃引進研發、工藝等關鍵領域人才以加強人才儲備及支持我們的持續發展。

基於績效的激勵機制。我們計劃完善激勵機制，針對各部門及個人制定考核計劃，建設基於績效的評價體系。通過股權激勵、創新獎勵等方式，強化核心人才隊伍的穩定性與凝聚力，提升協作效率。

我們的產品

按應用領域劃分的PCB產品

我們為下列應用領域提供關鍵的PCB產品，這些產品對終端客戶產品的功能與性能至關重要：(i)**數據通訊**，包括：高速網絡交換機及路由器；AI服務器及HPC；通用服務器及無線通訊網絡及其他；(ii)**智能汽車**，包括汽車智能及電動化系統，以及安全系統及其他；(iii)**工業控制及其他**。我們與終端客戶緊密合作，為其應用開發並製造

業 務

PCB。我們參與終端客戶的產品開發全過程，以應對信號完整性、熱管理及尺寸穩定性等技術挑戰。我們所提供的高性能與高信賴性PCB解決方案，不僅能滿足客戶的量身定制需求，更是確保終端客戶產品展現卓越性能與可靠穩定運行的關鍵因素之一，對其在各自應用領域的市場成功至關重要。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2025年及2026年3月31日止三個月，PCB產品銷售分別佔我們總收入95.9%、96.3%、95.8%、96.2%及95.3%。下表列出我們在所示期間按應用領域劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月					
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年			
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%		
	(未經審計)											
銷售PCB產品												
數據通訊.....	5,870,210	65.7	10,093,267	75.7	14,656,300	77.4	3,126,146	77.4	5,088,745	81.9		
高速網路交換機及路由器.....	2,524,874	28.2	3,892,081	29.2	8,169,083	43.1	1,559,046	38.6	3,171,199	51.0		
AI服務器及HPC.....	1,240,089	13.9	2,975,303	22.3	3,006,250	15.9	733,924	18.2	794,555	12.8		
通用服務器.....	1,606,556	18.0	1,960,641	14.7	2,540,451	13.4	512,951	12.7	972,829	15.7		
無線通訊網路及其他 ⁽¹⁾	498,691	5.6	1,265,242	9.5	940,516	5.0	320,225	7.9	150,162	2.4		
智能汽車.....	2,158,009	24.1	2,408,447	18.1	3,044,579	16.1	655,388	16.2	734,923	11.8		
汽車智能及電動化系統 ⁽²⁾	317,810	3.6	549,491	4.1	1,179,306	6.2	224,505	5.6	294,749	4.7		
安全系統及其他 ⁽³⁾	1,840,199	20.5	1,858,956	14.0	1,865,273	9.9	430,883	10.6	440,174	7.1		
工業控制及其他 ⁽⁴⁾	543,654	6.1	337,273	2.5	442,429	2.3	100,935	2.6	99,008	1.6		
小計.....	8,571,873	95.9	12,838,987	96.3	18,143,308	95.8	3,882,469	96.2	5,922,676	95.3		
其他 ⁽⁵⁾	366,436	4.1	502,554	3.7	801,913	4.2	155,158	3.8	291,480	4.7		
總計.....	8,938,309	100.0	13,341,541	100.0	18,945,221	100.0	4,037,627	100.0	6,214,156	100.0		

附註：

- (1) 其他主要包括應用於數據通訊領域的測試，涵蓋設計驗證、產品功能驗證、系統級測試及工藝可靠性評核等測試。
- (2) 汽車智能系統主要包括智能座艙、自動駕駛輔助系統、智能車身控制。電動化系統主要包括電源管理系統、逆變器和車載充電系統。
- (3) 安全系統主要包括剎車、轉向、安全氣囊等系統。其他主要包括引擎及變速箱控制單元，例如汽車照明、車身控制系統、儀表盤及抬頭顯示等。
- (4) 工業控制主要包括馬達控制和工業自動化邏輯控制器等。其他主要包括電源設備及用於醫療設備的控制面板等。
- (5) 包括可回收邊角料銷售所產生的收入，以及物業銷售和租賃業務所產生的收入。

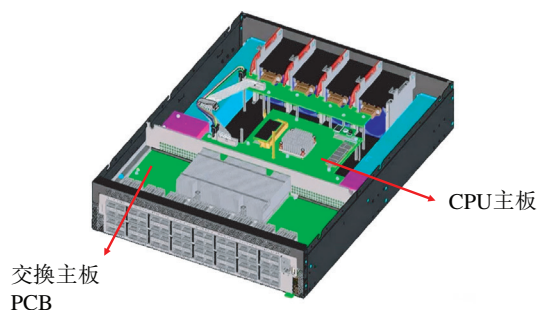
數據通訊

數據通訊領域涵蓋多種應用，我們的產品主要用於為數據中心（包括高速網絡交換機及路由器、AI服務器及HPC和通用服務器）和無線通訊網絡等設施各組件間的數據傳輸提供支持。我們的PCB滿足此領域對高速數據處理和傳輸、高通流容量、低延遲和高信賴性的嚴格要求。

業 務

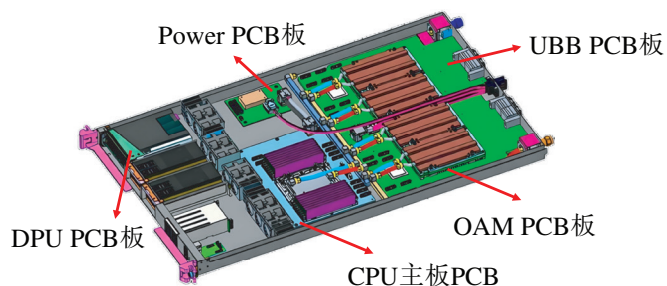
高速網絡交換機及路由器

我們提供用於高速網絡交換機及路由器的PCB，其作為數據中心和企業網絡的基礎架構，通常具有超高帶寬和超低延遲的特點。我們的產品組合涵蓋適用於大尺寸、高多層背板、線卡和配電盤中板的PCB。我們的產品組合側重於400G和800G交換機市場。我們實現了1.6T產品的量產並啟動了小批量出貨，同時推進3.2T及代際產品的先進研發與生產規劃工作。下圖為用於高速網絡交換機的PCB：



AI服務器及HPC

我們提供高多層PCB及HDI PCB，以滿足雲服務供應商所使用的最新GPU和定制ASIC，在密集並行處理能力下對高功耗的需求。我們的產品包括用於AI服務器的基板及CPU的主板和背板的高多層PCB，並為加速器模塊加速卡等應用提供HDI PCB。憑藉低損耗介電材料和先進製造工藝，我們的產品在高速、高密度的計算環境中展示出卓越的訊號完整性和電源完整性。下圖說明用於AI服務器的PCB示例：



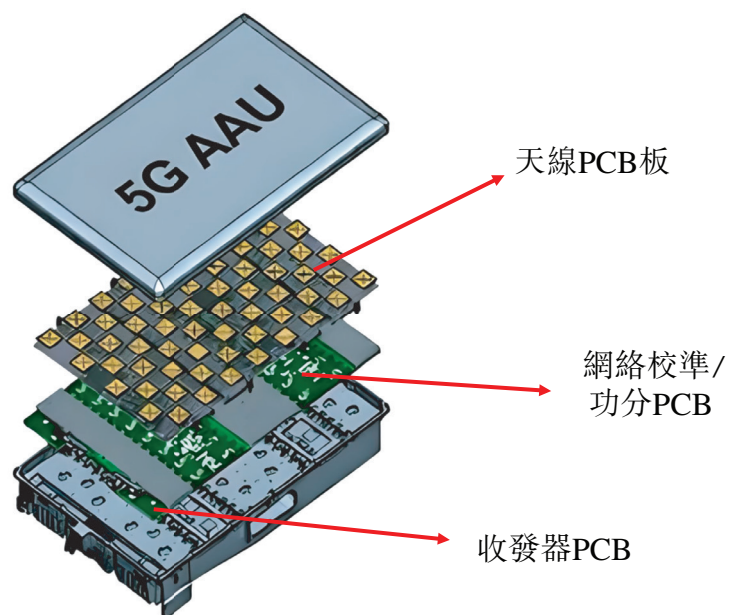
業 務

通用服務器

我們的通用服務器用PCB支持通用服務器內的標準計算操作。為滿足通用服務器對運行穩定性與跨平台兼容性的核心需求，我們提供具有卓越熱管理性能和電氣穩定性的高多層PCB產品。該等PCB的不間斷運行需要可靠且穩定的電氣性能。我們的產品應用於通用服務器的關鍵組件，如主板、存儲控制模塊及電源管理單元，助力客戶構建高效可靠的數據計算基礎設施。

無線通訊網絡及其他

我們提供作5G通訊基礎設施的PCB產品。我們的PCB廣泛應用於基站的無線電單元和天線等網絡設備，以及傳輸和核心網絡硬件。下圖說明用於無線通訊網絡的PCB：



業 務

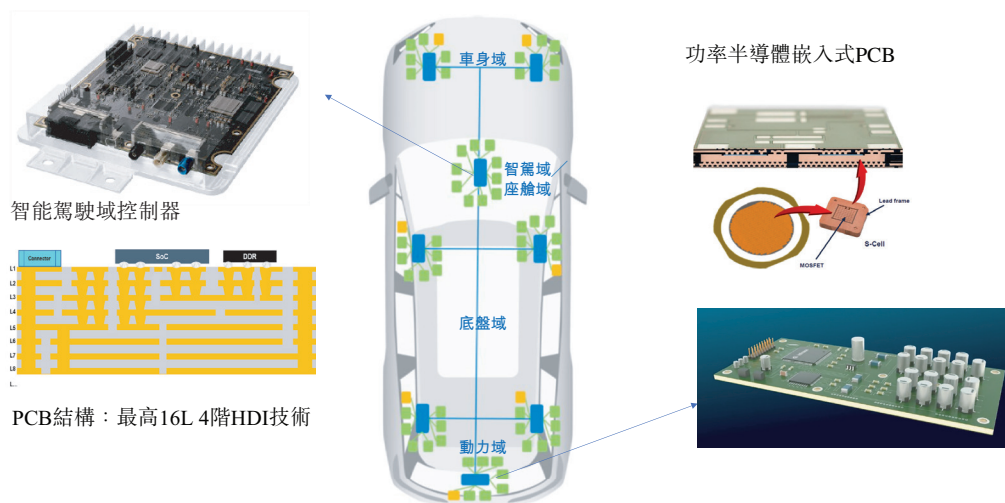
智能汽車

根據灼識諮詢的資料，汽車智能化及電動化趨勢已改變了車規級PCB的需求，每輛智能汽車的PCB價值約為傳統汽車的六至八倍。我們在智能汽車領域的產品專為車規級可靠性和提升性能而設計，涵蓋各類應用，包括：

汽車智能及電動化系統

智能駕駛艙系統。我們為適用於車輛內的HPC平台量產高達4階的HDI PCB。這些PCB主要應用於管理ADAS和智能駕駛艙功能的中央域控制器，以實現傳感器融合及複雜決策。例如，我們的PCB是毫米波雷達傳感器的關鍵組件，該等傳感器對ADAS和自動化駕駛功能至關重要。這些產品採用PTFE等專用基板製造，以確保高頻信號的完整性。

電源管理。我們提供採用功率半導體嵌入式PCB技術的PCB，該技術將功率半導體直接嵌入電路板。功率半導體嵌入式PCB用於新能源汽車的電池、發動機及電子控制系統以及電源模組。截至最後實際可行日期，此技術已應用於48V系統，我們正在開發此技術以應用於更高電壓的場景，例如採用碳化硅(SiC)等先進材料的電動汽車800V主逆變器。下圖說明用於智能汽車中汽車智能及電動化系統的主要PCB：



業 務

安全系統及其他

我們為各類汽車安全系統及其他應用提供PCB，包括照明、制動及轉向等引擎和變速箱控制單元。

工業控制及其他

本業務領域涵蓋對產品壽命、耐久度及工業環境適應性有要求的應用場景。我們為這些要求提供針對性的PCB，為專業應用領域提供支持。我們的產品適用於包括工業自動化設備及半導體包裝、測試及仿真設備等領域。

我們的PCB產品層數

於往績記錄期間，我們提供了不同層數的廣泛PCB產品組合，其中22至30層PCB以及32層及以上PCB佔我們收入的比例日益增長。層數較高的PCB通常代表更高的附加價值，因其生產涉及更精密的製造工藝與專業工程技術。雖然層數是衡量PCB複雜度及價值的主要指標，但其他屬性（例如製造工藝）對PCB產品亦至關重要。有關我們的若干專門製造工藝的進一步詳情，請參閱「－我們的技術」。下表按PCB產品層數列示了我們在所示期間的收入明細。

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
	(未經審計)									
銷售PCB產品										
32層及以上.....	761,065	8.5	1,768,206	13.3	4,249,764	22.4	647,810	16.0	1,993,541	32.1
22至30層.....	2,675,294	29.9	5,331,494	40.0	6,163,209	32.5	1,533,490	38.0	1,695,039	27.3
10至20層.....	2,364,869	26.5	3,014,701	22.6	4,226,842	22.3	892,886	22.1	1,381,425	22.2
八層及以下.....	2,770,645	31.0	2,724,586	20.4	3,503,493	18.6	808,283	20.1	852,671	13.7
小計.....	8,571,873	95.9	12,838,987	96.3	18,143,308	95.8	3,882,469	96.2	5,922,676	95.3
其他 ⁽¹⁾	366,436	4.1	502,554	3.7	801,913	4.2	155,158	3.8	291,480	4.7
總計.....	8,938,309	100.0	13,341,541	100.0	18,945,221	100.0	4,037,627	100.0	6,214,156	100.0

附註：

(1) 包括可回收邊角料銷售所產生的收入，以及物業銷售和租賃業務所產生的收入。

業 務

下表載列於往績記錄期間我們PCB產品按層數劃分的銷量及平均售價（「平均售價」）：

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	銷量	平均售價	銷量	平均售價	銷量	平均售價	銷量	平均售價	銷量	平均售價
	人民幣千元／ (平方米)	平方米	人民幣千元／ (平方米)	平方米	人民幣千元／ (平方米)	平方米	人民幣千元／ (平方米)	平方米	人民幣千元／ (平方米)	平方米
銷售PCB產品										
32層及以上....	16,095	47.3	32,348	54.7	66,220	64.2	10,644	60.9	30,233	65.9
22至30層	147,103	18.2	260,637	20.5	278,908	22.1	71,266	21.5	71,556	23.7
10至20層	402,600	5.9	468,541	6.4	697,959	6.1	135,518	6.6	219,693	6.3
八層及以下....	1,840,761	1.5	1,877,035	1.5	1,942,092	1.8	452,198	1.8	460,421	1.9
總計	<u>2,406,559</u>		<u>2,638,561</u>		<u>2,985,179</u>		<u>669,626</u>		<u>781,903</u>	

我們的PCB產品按層數大致分為以下幾類。

32層及以上。我們最複雜的PCB具有高縱橫比，主要為高性能及高信賴性的數據中心應用及AI基礎設施而開發。該等產品主要應用於800G及1.6T高速網絡交換機、路由器、AI服務器、定制ASIC加速器板以及半導體仿真與驗證系統等產品中。該等產品採用超低損耗材料（如M8及以上等級材料），確保高頻高速信號完整性。其中部分產品採用高度複雜的結構設計，例如三次及以上壓合（如N+N或N+M結構）以及HDI技術。HDI設計包含微孔（通過激光鑽孔形成的極小孔徑，用於連接相鄰層）和跨層盲孔（穿過多層但不與所有層連接的過孔）等特性。

22至30層。這些PCB主要為400G交換機、25/56 Gbps路由器以及AI服務器加速器模塊（如OAM及UBB板卡）而開發。該等產品採用低損耗材料，通常為M7級或更高。結構設計因應用而異。對於交換機及路由器應用，其結構主要由多層順序疊層構成。對於AI服務器加速器模塊，該等電路板採用先進的高密度設計，通常需要使用5階及以上HDI技術。

10至20層。該類別通常包括(i)數據通訊及(ii)智能汽車的產品：

在數據通訊領域，該等產品通常應用於通用服務器、數據存儲及通信基礎設施。應用領域涵蓋運行速率在25 Gbps及以下的交換機及路由器、通用服務器CPU主板、存儲背板以及5G基站組件（如收發器和基帶單元）。該等產品採用中低損耗材料製造，例如M4級或更高規格的材料。該結構基於單層疊層板並採用通孔設計，在需要提高密度時輔以HDI特性，如微孔及跨層盲孔。

業 務

在智能汽車領域，10至20層PCB主要專為先進汽車電子系統而開發，尤其是用於智能座艙及自動駕駛控制單元。其配備高性能運算芯片及其相關元件，以實現從車載資訊娛樂系統到L2+自動化駕駛等功能。該等PCB使用具備特定性能的材料製造，包括高熱可靠度及中等耗電特性，通常對應M4級或類似層壓板。結構上，該等產品一般採用混合設計，結合多層核心板與埋孔以及額外HDI階。此結構整合堆疊式激光鑽孔微孔，以實現支持高針腳數集成電路所需的高布線密度。

八層及以下。我們的八層及以下PCB適用於包括(i)汽車應用，例如電力系統控制器、車身控制器、毫米波雷達、照明、儀錶顯示器及剎車系統及(ii)數據通訊應用，例如5G基站天線與功率放大器，以及交換機、路由器和服務器各類擴展卡等應用領域。

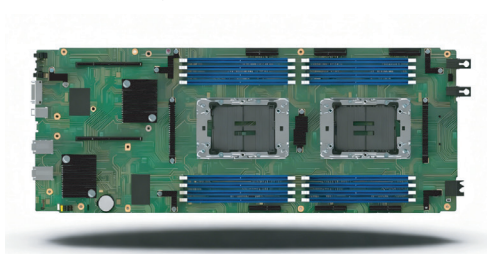
我們的技術

核心技術

我們憑藉核心技術實力，能針對持續變化的客戶需求開發及定制高性能及高信賴性PCB。以下列舉了我們部分核心技術亮點。

高多層板技術。我們在高多層板的研發與製造領域擁有專業技術，有能力進行高達108層的板材製造，以及78層的盲孔電路板生產。我們已實現40至60層範圍PCB的穩定大規模生產。我們在管理關鍵性能指標方面擁有專業技術，包括層間對準精度、層壓可靠性及阻抗一致性控制。下圖為我們的高多層PCB的示例：

服務器主板（24層）

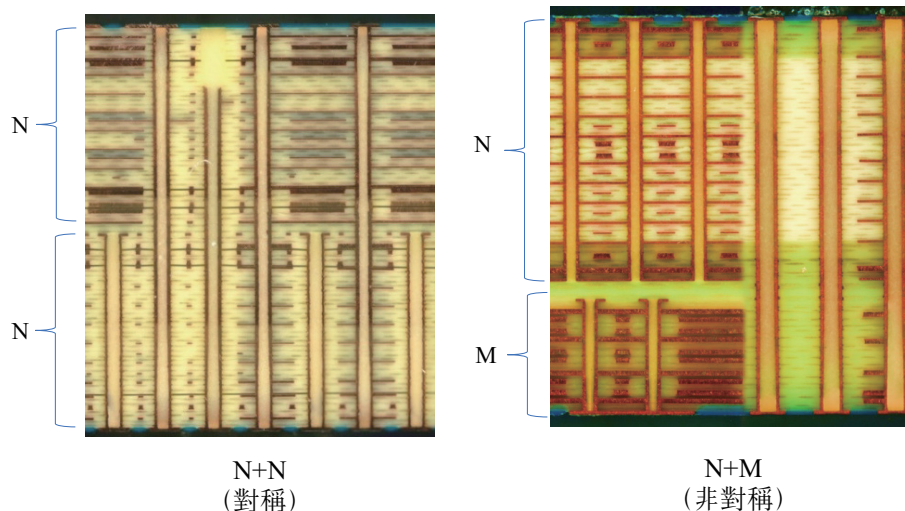


交換機主板（40層）



業 務

部分高多層PCB採用三次或以上壓合技術製造。此技術用於生產「N+N」及「N+M」結構的PCB，分別指對稱與非對稱結構。下圖說明N+N及N+M PCB結構：



於N+N結構下，核心兩側的層數相等，其層疊結構在兩側設計對稱一致，可提供均衡電器性能並降低電路板彎曲或變形的風險。此結構常用於需要高尺寸穩定性及一致信號完整性的產品，例如AI服務器、HPC及800G高速網絡交換機。相比之下，於N+M結構下，核心兩側的層數不相等，允許更大設計靈活性以滿足差異化功能需求。此結構常用於需要高供電需求的產品，如1.6T/3.2T的高速路由器及交換機，於此類產品中，緊湊尺寸、異質信號布線、供電、電源完整性為優先考量。

三次或以上壓合技術可實現超過44層板的可靠量產，達到低於100微米的精準對位精度。其亦能集成專門高速材料進行混合建構，確保客戶組裝過程中的訊號完整性及板材穩定性。此外，我們運用專門技術，如高縱橫比的微孔電鍍填孔、0.9毫米球柵陣列（「BGA」）雙軌背鑽、超大尺寸面板、板彎翹曲控制及無引線硬金，這些技術皆用於加強高多層PCB製造流程。我們的高多層板技術是我們產品的核心基礎，適用於超大規模數據中心、雲端服務提供商數據中心及通信基礎設施等應用場景。

業 務

高頻高速材料及工藝。我們在高頻高速材料與高速氧化工藝組合運用、超低背鑽殘樁控制技術及高精度線路阻抗／過孔阻抗控制技術方面具備先進能力。這使我們能夠在確保信號完整性的同時最大限度地降低插入損耗和回波損耗，從而打造出滿足高速信號傳輸嚴苛介電性能要求的複合電路板結構。

我們已成功將這些技術應用於800G及1.6T網絡交換機的PCB產品，並正積極開發適用於下一代每通道448 Gbps應用的材料與工藝解決方案。

HDI技術。高密度互連板（「HDI」）是一種PCB製造技術，採用逐層壓合構建的工藝方式，相比傳統多層PCB能實現顯著更高的線路密度。該技術主要特點包括微孔（通常採用激光鑽孔）、更精細的線寬線距，以及更高的焊盤連接密度。此技術有助設計及生產更輕薄短小、功能更複雜的電子設備。對於高性能產品而言，HDI技術不僅能改善佈局密度、減少體積和重量，更可提升信號傳輸質量，從而全面提升產品性能表現。

我們已實現最高達七階結構HDI PCB的批量生產，並已獲客戶認證，可生產11階HDI的產品。通過在精密堆疊工藝中採用HVLP4及低輪廓銅箔等先進材料，我們能夠構建互連結構，顯著提升信號傳輸速度與完整性。我們對產品翹曲亦實施嚴格控制，確保直徑大於100毫米的BGA翹曲量小於100微米，從而保障組裝與運行過程中的物理穩定性和可靠性。

高通流技術。我們的高通流產品採用厚銅基板及具有高熱穩定性的材料製造。通過優化的電源平面架構及熱設計，我們實現了高效的電流傳輸與熱量散發。具體而言，為應對局部電流需求極高的應用場景，特別是在電源管理產品領域，我們進一步採用稱為銅鑲嵌的先進技術。此流程是將定制化實心銅塊直接嵌入PCB結構中。該等嵌入式銅元素經特殊設計，既能與表面導線水平互連，又能與內部電源層垂直互連，從而實現極高的電流密度的傳輸。我們的高通流技術對於高功率應用至關重要，例如AI數據中心設備及智能汽車的電源模塊，該等領域對可靠的供電及熱管理有着關鍵需求。

業 務

其他技術

除上述核心技術外，我們亦掌握其他關鍵技術及生產工藝，該等對產品的迭代升級及生產能力的提升至關重要。以下為我們持有專利的其他技術的選定例子：

功率半導體嵌入式PCB技術。此技術是一種可將功率半導體（如MOSFET）直接嵌入PCB內部層的技術。根據灼識諮詢的資料，此技術具備擁有優化的熱管理與功率密度、更快的切換頻率、提升的電壓抗擾性、緊湊的尺寸設計及降低的電磁干擾等優勢。我們的功率半導體嵌入式PCB產品主要應用於汽車的電源系統。我們亦正開發用於高壓電動車的新一代功率半導體嵌入式PCB技術PCB解決方案，通過嵌入碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)功率半導體實現技術升級。

超高密度電路(「VHDC」)技術。此技術可提升高速信號傳輸應用中的信號完整性。此技術透過製造更趨矩形輪廓且更低表面粗糙度的導體，可降低信號損耗，並實現超細線寬與間距結構(25/25微米)的製作，可支撐數據傳輸速率達448 Gbps的先進交換機產品的技術需求。

垂直導電結構技術。此技術可提升互連密度並改善信號性能。其採用垂直實體導電結構取代傳統電鍍通孔，能實現更細密的BGA間距並增加電路密度。設計中整合了專用屏蔽與貫通孔配置，以降低信號串擾，對於未來應用於3.2T及下一代的交換機及路由器的技術至關重要。

功率強化及導電陽極絲抑制技術。此技術針對大尺寸芯片的高電流高功耗輸送需求而設計，尤其適用於AI及其他高性能運算應用。此技術能實現製造厚銅供電層(3盎司及以上)PCB，並有效提升載流面積。此工藝也改善BGA的平坦度，是大規模集成電路可靠組裝的關鍵因素。

研究與開發

研發團隊與投入

我們聚焦不同應用領域（特別是數據通訊與智能汽車）的終端客戶需求變化，將研發資源集中投入於技術與先進製造工藝的開發。

截至2026年3月31日，我們的研發團隊由2,145名員工組成，其中43.6%擁有學士或以上學位，20.3%的員工任職年資超過10年。我們的研發團隊在PCB技術、產品創新、材料科學和先進製造工藝方面擁有豐富的行業經驗。我們營造出一個讓研發人員

業 務

接觸並投身於研究、複雜技術挑戰及新興知識領域的環境。我們對技術創新的投入獲得了業界和政府的認可。例如，在2024年，我們的研發項目成功入選「江蘇省前沿技術研發項目立項」，並獲評「昆山市研發投入突出貢獻企業」。

系統化研發模式及流程

以下是我們研發模式的主要環節：

- **產品要求定義。**此階段包括與客戶溝通以瞭解其要求、市場和技術研究、對擬議產品的可行性分析以及正式的項目啟動和規劃決策。
- **概念與規劃。**項目獲得批准後，我們的團隊將著手進行初步和詳細的技術設計，包括選擇技術方向、建立開發流程圖以及創建詳細製造流程。
- **詳細的建模與仿真。**我們的工程團隊會進行信號完整性和熱仿真分析，以預測產品性能。我們亦會制定初步的可製造性設計規則，以確保產品的可擴展性。
- **設計和開發。**我們製作小批量原型，用於內部測試和客戶評估，以驗證概念，並進行實驗設計，以驗證和優化關鍵工藝參數。該階段可能需要五到二十四個月，具體取決於複雜性和設備開發需要。
- **驗證與確認。**我們對原型進行電氣、熱和機械可靠性測試，並將結果與仿真模型進行對比，以驗證工藝的穩定性。於全面生產前，我們還進行故障分析，以完善產品研發和製造流程。
- **模型校準與規則確定。**基於測試和驗證的結果，我們對仿真模型進行校準，並最終確定批量生產的設計規則和工藝規格。
- **試生產、批量生產和持續改進。**經過驗證後，產品將進入試生產及批量生產階段。我們的研發和工程團隊將繼續參與，監控生產過程，推動持續的工藝改進，並支持產品改進和升級。

重點研發領域與項目

我們的研發聚焦於主要的下游應用領域，特別是高速、高密度數據通訊領域。在該等領域，技術迭代與跨學科融合正推動需求。我們的研發項目包括產品開發項目，旨在開發新產品或升級現有產品以進行商業化；以及製程或技術開發項目，旨在提升製造工藝能力，以滿足當前及未來產品的需求。

業 務

在數據通訊領域，研發重點聚焦於開發支持448 Gbps及以上單通道傳輸速率的新一代產品技術，包括研發高速材料、信號與電源完整性、複雜高密度結構，以及多層壓合PCB的產品可靠性。在智能汽車領域，我們注重智能駕駛與車輛電動化。為滿足L3/L4駕駛系統要求，我們開發更高信賴性材料、精細線路、高深徑比電鍍、更高階HDI能力、更小激光鑽微孔以及對位精度等技術。於往績記錄期間，我們進行了191項研發項目，其中56項涉及新產品開發，134項涉及產品升級及技術開發。截至最後實際可行日期，92項研發項目已完成並應用於我們的產品中，其餘項目則仍在進行中。下表載列我們於往績記錄期間進行的一些主要研發項目：

項目名稱	項目目標
新一代網絡交換機產品開發(1.6T)...	建立用於網絡交換機的新一代產品量產能力。
背鑽殘樁控制能力提升	改進殘樁長度公差控制（殘樁長度最高為0.125毫米），以符合224 Gbps產品的要求。
嵌入式高壓芯片PCB替代材料開發 ..	開發不同性能等級的國產材料，提升我們在此領域的技術水平。
超大尺寸芯片封裝熱形變研究	滿足超大尺寸芯片組裝的熱形變要求。
汽車域控制器0.35毫米間距	優化產品結構並提升技術加工能力，提高我們的PCB與先進芯片組件之間的兼容性。
BGA功能開發	為優化產品結構及提升技術處理能力，推進我們在高階HDI生產方面的技術發展。
高階HDI激光微孔≤2 mil	開發新技術以提升我們的產品處理能力及市場競爭力。
對位精度開發	開發新型引線框產品以提升我們的產品競爭力。
高密度芯片嵌入技術研發	開發適用於MOSFET及IGBT芯片共嵌入的技術，擴大我們嵌入技術的應用範圍及靈活性。
專有芯片封裝引線框產品開發	開發下一代高速PCB材料，並透過技術規劃和佈局下一代產品來提升產品競爭力。
異質芯片共嵌入技術研發	建立用於下一代224 Gbps ASIC算力的量產能力。
下一代高速PCB板材研發	開發基於正交背的關鍵技術，滿足Tray與Rack正交互連技術的需求。
基於224 Gbps ASIC芯片算力	提升高階HDI加工可靠性技術，拓展產品結構。
模塊產品的研發	開發新技術，滿足224 Gbps速率帶寬需求。
AI超節點正交背板的研發	開發低成本技術方案，提升產品競爭力。
多階HDI(3+)在AI服務器上的應用研發	
224 Gbps速率Padless工藝研發	
112 Gbps低成本混壓方案研發	

知識產權

截至2026年3月31日，我們在中國擁有我們認為對業務及營運至關重要的53項專利、五項著作權、三個域名及十項註冊商標，以及兩項海外商標。請參閱「附錄四－法定及一般資料－B.有關我們業務的進一步資料－2.知識產權」。我們通過自主研發獲得專利。截至最後實際可行日期，我們擁有的專利及專利申請為我們自主開發所有。

業 務

我們通過商標、商業秘密及其他知識產權法以及與員工的保密協議來保障我們的知識產權。所有僱傭協議明確規定了有關知識產權所有權和保護的權利和義務。此外，我們要求員工簽署協議，規定彼等於為我們服務期間取得的任何服務發明、商業秘密及研發成果均應歸我們所有，且該等成果的所有權應轉讓予我們。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未遇到任何可能對我們的業務產生重大不利影響的知識產權侵權威脅或待決糾紛。

生產

生產設施

現有生產設施

截至2026年3月31日，我們於中國及泰國擁有合共五個進行PCB生產的主要生產基地。下表載列截至2026年3月31日該等生產基地之若干詳情：

生產設施	地理位置	生產起始年份	主要產品	總建築面積 (平方米)
昆山滬士電子 生產基地.....	中國蘇州市 昆山市	2014年 ⁽¹⁾	高速網絡交換機及路由器、AI服務器及HPC、無線通訊網絡及其他應用的PCB	265,336.3
昆山滬利微電生產 基地	中國蘇州市 昆山市	2007年	智能汽車應用的PCB	161,656.9
黃石生產基地.....	中國黃石市	2014年	(i)高速網絡交換機及路由器、AI服務器及HPC、無線通訊網絡及其他及(ii)智能汽車應用的PCB	180,157.0
金壇生產基地.....	中國常州市 金壇區	2019年	智能汽車應用的PCB	132,016.9
泰國生產基地.....	泰國	2024年	(i)高速網絡交換機及路由器、AI服務器及HPC及(ii)智能汽車應用的PCB	177,840.0

附註：

- (1) 昆山滬士電子生產基地於1995年在原址展開生產工序。2014年，我們將生產基地搬遷並擴大至現址。

擴產計劃

於往績記錄期間，為提升生產能力並加強我們的全球業務佈局，我們已在泰國投資建設一個新的生產基地（「**泰國生產基地**」）。泰國生產基地一期工程於2022年開工建設，並於2024年底完工，旨在生產高速網絡交換機、路由器、AI服務器及HPC應用的PCB。試生產約於2024年底開始，產能提升期約為一年，之後將實現穩定的量產。有關我們產能擴張的進一步詳情，請參閱「未來計劃及[編纂]用途—[編纂]用途」。此

業 務

外，於2026年，我們宣佈了四項重大擴產計劃：(i)於2026年1月，在金壇啟動一項聚焦於高密度PCB的CoWoP及mSAP技術的投資項目；(ii)於2026年2月，在昆山滬士電子生產基地推出以高層數、高頻高速、高密度互連及高通流PCB為重點的擴產計劃；及(iii)於2026年3月，在昆山滬利微電生產基地推出以高層數、高頻高速、高密度互連及高通流PCB為重點的擴產計劃；及(iv)於2026年4月，於昆山滬士電子生產基地推出新的擴產計劃。

產能及產量

下表載列於所示期間我們按生產基地分類的有效產能、產量和生產利用率：

	截至12月31日止年度			截至3月31日止三個月	
	2023年	2024年	2025年	2025年	2026年
昆山滬士電子生產基地					
有效產能 ⁽¹⁾ (平方米)	538,077	522,935	499,495	129,384	141,957
產量 (平方米)	443,160	514,882	498,846	129,215	141,773
利用率 ⁽²⁾ (%)	82.4	98.5	99.9	99.9	99.9
昆山滬利微電生產基地					
有效產能 ⁽¹⁾ (平方米)	1,449,321	1,466,018	1,143,137	222,054	239,937
產量 (平方米)	1,165,276	1,188,623	1,138,336	214,726	238,929
利用率 ⁽²⁾ (%)	80.4	81.1	99.6	96.7	99.6
黃石生產基地					
有效產能 ⁽¹⁾ (平方米)	1,243,885	1,278,146	1,575,407	358,236	439,507
產量 (平方米)	1,015,113	1,179,498	1,570,523	356,086	438,144
利用率 ⁽²⁾ (%)	81.6	92.3	99.7	99.4	99.7
金壇生產基地					
有效產能 ⁽¹⁾ (平方米)	201,978 ⁽³⁾	287,664	306,024	76,506	81,969
產量 (平方米)	87,489 ⁽³⁾	171,540	247,290	51,306	75,810
利用率 ⁽²⁾ (%)	43.3	59.6	80.8	67.1	92.5
泰國生產基地					
有效產能 ⁽¹⁾ (平方米)	—	—	95,806	—	36,752
產量 (平方米)	—	—	74,537	—	36,642
利用率 ⁽²⁾ (%)	—	—	77.8	—	99.7
整體利用率 (%)	79.0	85.9	97.5	95.6	99.1

附註：

- (1) 特定年度／期間的有效產能反映我們根據年度／期間生產計劃並基於每日24小時運作及每月30個運作日所估算的最大產量。在任何特定年度／期間，我們的有效產能會根據製造產品類型進行動態調整。例如，製造較複雜的產品可能涉及更長的生產時間及更繁複的生產步驟。因此，有效產能亦會降低，反之亦然。
- (2) 利用率是通過將產量除以有效產能計算得出。
- (3) 我們的金壇生產基地由江蘇勝偉策擁有並管理。於2023年合併江蘇勝偉策的財務報表，金壇生產基地2023年的有效產能及產量為截至2023年12月31日止八個月的數據。

業 務

我們的產能利用率主要受客戶需求波動所驅動，而非受季節性影響。第二季度和第四季度需求通常較為強勁，此時某些國內客戶會加快採購，而第一季度和第三季度則較為淡靜。新產品版本的推出或現有項目的替換也會影響利用率。隨著舊項目的逐步淘汰，需求亦可能會暫時下降；而在其他情況下，當新項目和現有項目重疊時，需求可能會增加。因此，我們的利用率會因生產線根據客戶需求和產品過渡進行調整而有所不同。

生產過程

我們在生產設施內部生產PCB，根據產品類型的不同，生產流程會有所差異。以下流程圖說明PCB生產過程中的一般步驟：

關鍵步驟	說明
內層生產	
裁切	將銅箔基板切割成標準工作面板尺寸
內層成像與蝕刻	將電路圖案轉移到銅箔上，蝕刻掉不需要的銅箔
內層AOI	檢查內層電路是否存在缺陷
壓合	將多層對齊並壓合成多層堆疊結構
外層生產	
邊緣打磨／修整	修剪板材邊緣，去除多餘的樹脂，確保邊緣乾淨整潔
鑽孔	鑽通孔和微孔以建立層間連接通道
電鍍	在孔壁和面板表面鍍銅，以形成導電通路
填充通孔	用樹脂或導電膏填充通孔，以提高信賴性和表面平整度
外層乾膜	塗敷乾膜光阻，為外層成像做準備
圖形電鍍	在成像的電路圖案上電鍍銅和錫並進行蝕刻以形成電路形狀
外層AOI	檢查外層電路是否存在缺陷以及是否準確
深度鑽孔	對需要信號完整性控制的信號孔結構進行可控深度鑽孔
阻焊膜印刷	印刷並固化阻焊油墨以保護銅箔線路
化學鍍金／鍍金	在焊盤上沉積鍍和金，以確保可焊性和耐用性
文字／字符印刷	在電路板表面絲印元件標識符和標記
外形銑切	通過銑切或沖壓將板件加工至最終尺寸
電氣測試	測試所有電路的傳導性和絕緣性
有機保焊劑	塗覆有機分子護塗層(OSP)以保護裸露的銅焊盤
錫和銀的塗覆	在焊盤上化學沉積錫和銀，以提高可焊性和導電性
最終檢驗與包裝	檢查成品板並打包待運

生產更先進或專門產品涉及額外且更為繁複的製造步驟。例如，製造具N+N積層結構的高多層PCB需對獨立子板進行平行處理，透過額外壓合將其組合。同樣地，生產功率半導體嵌入式PCB涉及專門流程，包括在壓合過程中將功率半導體嵌入板層內。

生產設備

我們的主要生產設備，包括激光曝光機、蝕刻線、層壓機、鑽孔機和電鍍線，主要從中國、德國和日本的成熟供應商處採購。我們通常會將生產設備調配到技術規格相若的產品線互相使用。若技術規格存在顯著差異時，則可能需要重新配置設備或

業 務

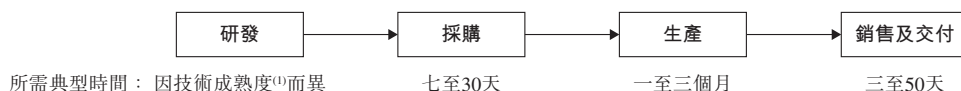
採用專用程序。對於新設施，我們採購相同規格的生產設備，以確保一致性。我們優先考慮設備的穩定性、精確性和可靠性，重點關注支持高多層和高密度PCB生產的技術。我們還營運鍋爐、X射線系統和叉車等專用設備，所有這些設備皆按照適用的監管要求進行維護和認證。

生產管理

我們將客戶訂單直接與生產計劃連接。我們的生產部門按照已確認的客戶訂單制定生產排程，從交貨日期倒推，以確定物料到貨及生產開始日期。一旦物料到貨，我們就會啟動生產，並根據訂單組合和工藝限制，在各產品線之間分配每日投入量。我們實時監控生產階段，跟進每個工藝的周期時間和產出，以確保生產量和交貨表現。我們監控生產設施和利用率，並更新生產計劃，以適應客戶的滾動要求。我們將產品分類到與特定工藝流程相匹配的生產通道中，優化產能利用率，並滿足客戶的交貨要求。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未經歷任何重大生產運營中斷或停工。

研發、生產及銷售周期

我們的業務涉及PCB產品的研發、生產及銷售，其典型周期如下方流程圖所示：



附註：

- (1) 採用成熟技術的研發項目通常能在一至六個月內完成交付，而涉及早期階段或複雜技術的項目則可能需要長達約兩年的時間。

質量控制

我們已取得並維持多項關鍵認證，包括質量管理體系的ISO9001認證及汽車質量管理體系的IATF16949認證。我們持有環境管理體系的ISO 14001認證、職業健康與安全體系的ISO 45001認證及有害物質過程管理體系要求的IECQ QC 080000認證。我們成立了一個專責質量控制團隊進行質量管理，並在整個生產周期透過各項流程實施質量控制。

業 務

進料質量控制。對所有進料原材料進行檢查和測試，如覆銅板、銅箔和制程化學品，以防止不合格材料流入。我們評估供應商質量，監控尺寸穩定性、Tg值、CTE以及銅表面粗糙度等特性，並遵守客戶對存儲條件和保質期的特定要求。

制程中質量控制。我們安排質保人員駐守生產線關鍵工序，持續監控壓合、鑽孔、電鍍及蝕刻等核心工藝參數，確保其始終處於規定的控制範圍內。我們跟蹤周期時間、工藝輸出以及環境條件並採取即時糾正措施。同時，我們還執行覆核系統，識別缺陷，並推動改進。

最終質量控制及出貨質量控制。所有成品在包裝出貨前均須通過最終檢查，其包括自動化與人工雙重外觀檢查、電性能測試及尺寸驗證，確保符合客戶規範與行業標準。成品在受控環境下進行包裝，物流過程都受到監控，以確保及時可靠的交付。此外，我們通過保護性塗層、控制存儲以及遵守客戶要求，控制氧化和潮濕方面的風險，從而管理產品的保質期（通常為從生產到組裝的一年時間）。

售後服務。我們設有處理不合格產品、客戶投訴及退貨的程序。我們的8D問題解決流程確保及時遏制問題、進行根因分析並提出糾正措施。我們亦制定緊急應變方案，以應對突發問題。

銷售及營銷

銷售網絡

於往績記錄期間，我們通過線下直銷方式銷售產品，並未聘用分銷商。我們的客戶主要包括電子製造服務（「EMS」）提供商，彼等製造並組裝我們的PCB，以供銷售予下游終端客戶。我們的產品於國內及國際市場均有銷售。於往績記錄期間，我們有相當部分產品在境外銷售，主要銷往亞洲其他地區、歐洲及美洲。下表列出所示期間基於產品交付目的地按地區分類的收入：

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月					
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年			
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	(未經審計)	
PCB產品銷售.....	8,571,873	95.9	12,838,987	96.3	18,143,308	95.8	3,882,469	96.2	5,922,676	95.3		
境外	7,217,521	80.7	11,104,063	83.2	15,542,868	82.1	3,330,546	82.5	5,243,337	84.3		
亞洲其他地區 ⁽¹⁾	3,955,267	44.2	7,275,278	54.5	10,319,401	54.5	2,193,714	54.4	3,741,917	60.1		
歐洲.....	1,116,720	12.5	1,078,035	8.1	1,379,064	7.3	322,615	8.0	360,178	5.8		

業 務

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
	(未經審計)									
美洲.....	1,100,420	12.3	1,983,674	14.9	3,215,112	17.0	663,423	16.4	980,539	15.8
保稅區.....	1,044,038	11.7	766,743	5.7	624,858	3.3	149,433	3.7	160,703	2.6
非洲及其他.....	1,076	0.0	333	0.0	4,433	0.0	1,361	0.0	-	-
中國內地 (不包括面向保稅區 的銷售).....	1,354,352	15.2	1,734,924	13.1	2,600,440	13.7	551,923	13.7	679,339	11.0
其他 ⁽²⁾	366,436	4.1	502,554	3.7	801,913	4.2	155,158	3.8	291,480	4.7
總計.....	8,938,309	100.0	13,341,541	100.0	18,945,221	100.0	4,037,627	100.0	6,214,156	100.0

附註：

- (1) 亞洲其他地區主要包括中國香港、中國台灣、泰國、馬來西亞及越南。
- (2) 包括可回收邊角料銷售所產生的收入，以及物業銷售和租賃業務所產生的收入。

保稅區

概覽

中國內地的保稅區是一種特殊海關監管區域，旨在促進轉口貿易、出口加工及國際運輸。在該類區域內經營的企業享有關稅、物流、進出口活動及海關程序方面的優惠政策。有關進一步詳情，請參閱「監管概覽－有關保稅區的法規」。

向保稅區進行銷售的海關和稅務處理

視同出口及適用的關稅安排。據我們的中國法律顧問告知，根據中國法律及法規，(i)出口企業通過海關申報交付至保稅區的貨品被視為出口貨品；及(ii)根據中國關稅規則，出口關稅僅對少數類別的貨物徵收，大多數出口貨物均免徵出口關稅，適用出口關稅稅率為0%。因此，就中國海關目的而言，我們向保稅區銷售產品符合出口資格，並且在海關申報時有資格獲得出口退稅及零出口關稅待遇。

解除海關相關責任，並毋須承擔後續海關及稅項責任。於交付及相關報關程序完成後，我們有關向保稅區銷售產品的海關相關責任即告完全解除。我們並不就下游客戶後續的產品流向承擔任何後續海關或稅項責任，例如後續目的地國家徵收的進口關稅。

業 務

具約束力的轉讓安排。產品於保稅區及其他特殊海關監管地區間的轉讓受中國法規下的保稅處理規限，且不會就有關轉讓徵收關稅或進口相關稅項。

通過保稅區進口物料。從海外進口至保稅區的物料不被視為進口至中國，並於入境點獲豁免進口稅項。倘有關物料會進行進一步加工，其後會移至中國內地其他地區，則於當時以製成品或半製成品的最終狀況，對有關貨品徵收進口關稅。

向保稅區安排產品銷售的優惠政策

在產品質量或生產流程上，我們銷售至保稅區的產品與銷售至海外市場的產品基本相同，惟技術規格會因應客戶需求而作調整。我們向保稅區銷售的相關優惠包括：

(i) **與客戶供應鏈結構的協調：**我們按客戶指示將產品銷售至保稅區，銷售至保稅區符合客戶所偏好的物流模式及全球供應鏈結構；(ii) **免徵出口關稅：**從保稅區運往海外市場的貨物可免徵出口關稅；(iii) **保稅區之間及區內的保稅轉移：**在不同保稅區之間轉移的貨物仍保持保稅狀態，並免徵關稅及進口相關稅費；(iv) **出口：**向保稅區及其他海關特殊監管區域銷售的商品視為出口，貨物申報後即可辦理清關手續並享受出口退稅；及(v) **簡化稅項管治：**區內企業自主辦理申報手續、建立合理的海關核查周期並實施自主申報。

銷售模式

我們採用直銷模式。我們通常與客戶簽訂主框架協議。標準協議的主要條款如下：

- **期限與終止。**期限通常為三至五年。協議可經雙方協商一致終止，或由任何一方提前書面通知終止。
- **定價政策付款與信用期。**價格由雙方共同設定，其參照商定的物料清單以及包裝及相關費用釐定。我們通常要求客戶在收到發票後付款。我們一般提供自發票日期起30至120天的信用期。
- **採購金額。**採購金額載於採購訂單中，列明型號、數量、價格、目的地及發貨日期。

業 務

- **產品保證及退貨安排。**我們一般就符規、規格、適銷以至產品無缺陷作出保證。特定保證責任包括替換或維修有缺陷的產品，並分析故障的根本原因。我們通常不允許退貨，除非在貨品不符或存在缺陷等有限情況下，在此情況下我們將提供更換、維修或退款安排。
- **交付與物流。**我們負責將產品送至客戶指定地點，通常以工廠交貨方式或另行約定的方式進行。
- **保密與知識產權保護。**雙方均不得披露其他合同訂約方的保密信息。

銷售代理

於往績記錄期間，就若干海外市場的銷售而言，我們委聘了以佣金制合作的銷售代理。我們委聘銷售代理，主要是為了利用彼等本地化的專業知識、成熟網絡及文化能力，以便與海外客戶對接，並以具成本效益的方式拓展全球版圖。下表列示於往績記錄期間及截至最後實際可行日期根據銷售代理的註冊地址按地區劃分的銷售代理數目：

	截至12月31日			截至 3月31日	截至最後 實際可行 日期
	2023年	2024年	2025年	2026年	
亞洲及其他.....	5	5	8	8	8
歐洲	5	6	6	6	6
美洲	7	7	7	7	7
總計	17	18	21	21	21

於2023年、2024年、2025年以及截至2025年及2026年3月31日止三個月，與銷售代理相關的收入分別為人民幣6,528.7百萬元、人民幣9,087.4百萬元、人民幣12,792.9百萬元、人民幣2,485.6百萬元及人民幣4,045.5百萬元，佔同期我們總收入的約73.0%、68.1%、67.5%、61.6%及65.1%，而與銷售代理相關的銷售佣金分別為人民幣214.1百萬元、人民幣288.2百萬元、人民幣412.1百萬元、人民幣88.3百萬元及人民幣131.9百萬元。

我們與銷售代理之間採用委託代理關係。彼等以我們的品牌營運，不擁有我們產品的所有權，且不處理訂單履行或付款事宜。與經銷商不同——經銷商(i)以自身名義購買產品，作為主要訂約方；(ii)承擔庫存風險及信貸風險；及(iii)轉售給終端客戶，而我們的銷售代理僅代表我們介紹客戶並支持交易，而我們仍是唯一的簽約方，並直接

業 務

保有客戶關係。根據灼識諮詢的資料，PCB製造商委聘銷售代理(i)識別現有及潛在客戶的產品需求並促進溝通；及(ii)提供銷售協調、客戶開發及關係管理等本地化支援，乃行業慣例，此類合作十分常見且符合行業實踐。於甄選代理時，我們考慮以下因素：(i)是否符合客戶開發計劃及接觸客戶的能力；及(ii)於相關當地市場的人脈網絡。

於往績記錄期間，除WUS Printed Circuit (Singapore) Pte., Ltd. (「**WUS Printed Circuit Singapore**」，本公司關聯方，曾於2023年及2024年擔任我們的銷售代理)外，我們所有銷售代理均為獨立第三方。自2024年7月起，WUS Printed Circuit Singapore的銷售代理職能已由我們的附屬公司WUS Singapore承擔。2023年及2024年，計提WUS Printed Circuit Singapore的銷售佣金分別為人民幣6.9百萬元及人民幣1.4百萬元。詳情請參閱附錄一會計師報告附註39。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，除銷售代理職能由WUS Printed Circuit Singapore轉至WUS Singapore外，我們並無終止與任何銷售代理的業務關係。

我們直接與銷售代理訂立協議。協議通常為兩年的固定期限，除非提前通知終止，否則將自動續期兩年。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無與銷售代理及客戶訂立任何三方協議。我們與銷售代理訂立的協議的主要條款通常包括：

授權範圍及非獨家性。銷售代理獲授權以非獨家基準招攬訂單及介紹客戶，且未經我們事先同意，不得簽訂合約或對我們具有約束力。

責任。銷售代理負責推廣我們的產品、維持客戶關係，並提供市場最新資訊。我們不設任何最低採購要求、銷售承諾或表現目標。我們每年向代理提供賬戶狀況確認書，其中詳細列明獲指派的客戶及適用的佣金率。銷售代理須對我們的技術及商業資料保密。

佣金率及計算基準。銷售代理的報酬為佣金，按每張訂單發票所列示的FOB價格百分比計算，並按月支付。於往績記錄期間，佣金率通常介於2.0%至5.0%。每名代理的佣金率由代理與我們的管理層按公平原則磋商釐定，並考慮服務範圍、策略價值及客戶訂單量、地區現行市場費率及產品類型。佣金費用並不包括在合同約定產品售價內，而是我們與銷售代理另行結算，並於綜合損益表中確認為銷售及營銷開支。請參閱「財務資料－經營業績－銷售及營銷開支」。

業 務

我們相信本集團並未對任何銷售代理構成不當或過度依賴，原因如下：(i)**直接擁有客戶關係**：我們保留所有客戶合約、知識產權及產品認證的最終擁有權。由於客戶會直接對我們的製造工廠進行審核及認證，銷售代理難以輕易將客戶帶給競爭對手；及(ii)**獨立營運能力**：我們自行管理核心商業職能，包括產品設計、生產、品質控制、物流及定價策略，銷售代理嚴格作為外部業務拓展促進者，而非中間人或分銷商。

定價

我們的定價模式結合成本加成及市場導向方法，這體現了PCB的定制化及技術性特點。我們根據技術複雜性、製造工藝、阻抗控制要求、原材料成本、行業認證和標準、客戶訂單量和市場狀況等因素為產品定價。我們會根據市場基準、客戶質量要求、客戶關係管理、競爭態勢以及目標市場份額進行調整。總體而言，海外客戶重視整體表現、關係穩定度、技術能力及產品質量，而國內客戶往往對價格更為敏感。我們可能會實施靈活的定價安排，以維護關鍵客戶關係。

營銷

我們的銷售及營銷團隊致力於與目標終端市場中的客戶建立長期合作關係。我們根據客戶的技術需求、市場定位及形象定制方案。對於有標準技術要求的終端客戶，我們強調響應能力和服務質量；而對於高端客戶，我們則注重技術、可靠性和長期合作。我們與終端客戶合作，確保雙方技術路線圖保持一致。例如，通過與一名戰略合作夥伴共同開發功率半導體嵌入式PCB技術，我們在進入商業合作之前，與汽車供應商及客戶進行早期討論以達成共識，並深入了解市場動態。

退貨、客戶反饋與服務

當發生質量問題時，我們的專責團隊將啟動應對流程，進行根本原因分析並實施糾正及預防措施以解決問題。我們定期進行客戶回訪，保持溝通，以便發現潛在問題。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未收到客戶任何重大不滿、產品退貨、換貨、投訴或產品責任索賠。我們於往績記錄期間及直至最後實際可行日期未產生任何重大的保修費用或為此類重大保修費用計提任何重大撥備。

業 務

客戶

於往績記錄期間，我們的客戶主要包括EMS供應商，該等供應商將我們的PCB與其他元件組裝整合後，銷售給下游終端客戶。終端客戶通常是最終品牌擁有人或產品設計公司，包括在數據通訊、智能汽車及工業控制等領域享譽全球的公司。在少數情況下，我們亦直接向該等終端客戶進行銷售。於往績記錄期間各年度／期間，我們於各相關年度／期間自五大客戶獲得的收入合共分別為人民幣4,111.5百萬元、人民幣6,792.0百萬元、人民幣10,102.8百萬元及人民幣3,628.7百萬元，分別佔我們總收入的46.0%、50.9%、53.3%及58.4%。此外，於往績記錄期間各年度／期間，我們於各相關年度／期間自最大客戶獲得的收入分別佔我們總收入的13.8%、12.3%、14.3%及19.5%。據我們所深知，於往績記錄期間各年度／期間，我們五大客戶均為獨立第三方。據我們所深知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的主要客戶均非我們的供應商，反之亦然。據我們所知，截至最後實際可行日期，未發現可能導致與主要客戶合作關係終止的任何資料或安排。於往績記錄期間各年度／期間及直至最後實際可行日期，我們的董事及其聯繫人，或擁有已發行股份總數5%或以上的股東，均未在五大客戶中擁有任何權益。下表載列於往績記錄期間各年度／期間我們五大客戶的詳情。

排名	客戶	銷售金額 (人民幣千元)	佔總收入 百分比 (%)	購買的 產品／服務的 主要類別	信貸期	付款方式	客戶類別	業務關係起 始年份
截至2023年12月31日止年度								
1	客戶A ⁽¹⁾	1,231,130	13.8	用於數據通訊的PCB	60至120天	電匯	EMS	2003年
2	客戶B ⁽²⁾	863,424	9.7	用於數據通訊的PCB	30至120天	電匯	EMS	2002年
3	客戶C ⁽³⁾	724,857	8.1	用於數據通訊的PCB	60至90天	電匯	EMS	2018年
4	客戶D ⁽⁴⁾	664,619	7.4	用於智能汽車的PCB	60至120天	電匯	終端客戶	2001年
5	客戶E ⁽⁵⁾	627,498	7.0	用於數據通訊的PCB	75至110天	電匯	EMS	2011年

排名	客戶	銷售金額 (人民幣千元)	佔總收入 百分比 (%)	購買的 產品／服務的 主要類別	信貸期	付款方式	客戶類別	業務關係起 始年份
截至2024年12月31日止年度								
1	客戶A	1,638,375	12.3	用於數據通訊的PCB	60至120天	電匯	EMS	2003年
2	客戶E	1,502,232	11.3	用於數據通訊的PCB	75至110天	電匯	EMS	2011年
3	客戶C	1,473,887	11.0	用於數據通訊的PCB	60至90天	電匯	EMS	2018年
4	客戶B	1,310,682	9.8	用於數據通訊的PCB	30至120天	電匯	EMS	2002年
5	客戶F ⁽⁶⁾	866,845	6.5	用於數據通訊的PCB	60至90天	電匯	EMS	2013年

業 務

排名 ...	客戶	銷售金額 (人民幣千元)	佔總收入 百分比 (%)	購買的 產品／服務的 主要類別	信貸期	付款方式	客戶類別	業務關係起 始年份
截至2025年12月31日止年度								
1	客戶E	2,702,321	14.3	用於數據通訊的PCB	75至110天	電匯	EMS	2011年
2	客戶F	2,153,938	11.4	用於數據通訊的PCB	60至90天	電匯	EMS	2013年
3	客戶A	2,068,452	10.9	用於數據通訊的PCB	60至120天	電匯	EMS	2003年
4	客戶B	1,803,764	9.5	用於數據通訊的PCB	30至120天	電匯	EMS	2002年
5	客戶C	1,374,286	7.3	用於數據通訊的PCB	60至90天	電匯	EMS	2018年

排名	客戶	銷售金額 (人民幣千元)	佔總收入百分比 (%)	購買的產品 ／服務的 主要類別	信貸期	付款方式	客戶類別	業務關係 起始年份
截至2026年3月31日止三個月								
1	客戶F	1,211,804	19.5	用於數據通訊的PCB	60至90天	電匯	EMS	2013年
2	客戶E	728,375	11.7	用於數據通訊的PCB	75至110天	電匯	EMS	2011年
3	客戶A	601,846	9.7	用於數據通訊的PCB	60至120天	電匯	EMS	2003年
4	客戶B	555,974	9.0	用於數據通訊的PCB	30至120天	電匯	EMS	2002年
5	客戶C	530,677	8.5	用於數據通訊的PCB	60至90天	電匯	EMS	2018年

附註：

- (1) 客戶A是一家於台灣證券交易所上市的公眾公司的附屬公司，主要從事網絡通訊設備、車聯網及智能硬件的研發、製造與銷售。
- (2) 客戶B是一家總部位於美國奧斯汀的上市公司，在納斯達克上市，主要通過代工製造模式從事消費電子、計算及通訊硬件的研發、製造與銷售。
- (3) 客戶C是一家總部位於台灣的上市公司，在台灣證券交易所上市，主要從事筆記本電腦、服務器及其他消費電子組件的開發、製造與銷售。
- (4) 客戶D是一家總部位於德國漢諾威的上市公司，在法蘭克福證券交易所上市的，主要從事汽車零部件、汽車電子、安全及底盤系統、輪胎及出行技術的開發及製造。
- (5) 客戶E是一家總部位於加拿大多倫多的上市公司，同時在多倫多證券交易所及紐約證券交易所上市，主要從事服務器、存儲及通訊系統等電子硬件的開發、製造與銷售。
- (6) 客戶F是一家總部位於台灣的上市公司，在台灣證券交易所上市，主要從事網絡及數據中心交換設備的開發、製造與銷售。

我們的供應鏈

原材料

我們的關鍵原材料主要包括覆銅板、半固化片、銅箔、陽極銅、金鹽及乾膜，主要採購自中國內地供應商。這些材料對於生產高密度及多層產品十分重要。為管理及減輕原材料價格波動的影響，我們已實施以下措施：(i)關注市場行情並與供應商磋商條款；(ii)於銷售協議中採用靈活的定價機制，以及定期進行價格調整，以使售價與市

業 務

場供需保持一致；(iii)採用靈活策略，以調整採購量與庫存管理策略；(iv)整合集團層面的採購計劃，以利用規模優勢進行價格磋商；及(v)與關鍵供應商訂立框架協議，以獲得穩定的供應。於往績紀錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未就原材料價格波動採納任何對沖政策；我們並未經歷任何重大的原材料供應短缺，且所供應的原材料並無任何重大質量問題。

供應商

供應商遴選及管理

我們依照嚴格的篩選流程及考慮產品質量、產能規模、往績記錄及價格競爭力等因素後篩選供應商。潛在供應商需經過資格認證流程，包括資質與現場評估、樣品測試及性價比評估。我們通過績效評估體系管理供應商，涵蓋定期評級與現場稽核並對質量承諾、培訓、進貨檢驗、統計追蹤及不符合項處理流程進行評估。我們通常會與主要供應商簽訂框架協議。框架協議的主要條款載列如下：

期限、終止及保密。協議通常為期一年，可自動續期一年，或任何一方可提前發出書面通知予以終止。我們要求供應商對協議詳情保密。

產品規格、定價與付款。每份採購訂單中列明產品規格、價格、數量及交付時間表。我們通常享有約30至150天的信貸期。

交付及物流。供應商通常負責將產品運送至指定的地點。

風險轉移及產品退換。經檢驗及收貨後，風險即轉移至我們。我們有權拒收、更換或退還不符合規定的產品。供應商須就經判定應歸責於供應商的質量缺陷所產生的損失對我們進行彌償。

主要供應商

我們的主要供應商主要為PCB生產提供關鍵原材料及／或設備。於往績記錄期間各年度／期間，五大供應商於各相關年度／期間的採購額分別為人民幣2,179.0百萬元、人民幣3,936.1百萬元、人民幣5,972.7百萬元及人民幣2,179.4百萬元，分別佔我們總採購額的41.3%、40.5%、42.2%及41.6%。此外，於往績記錄期間各年度／期間，最大供應商於各相關年度／期間的採購額分別佔我們的採購總額21.4%、21.1%、22.3%及21.2%。於往績記錄期間各年度／期間及直至最後實際可行日期，我們的五

業 務

大供應商均為獨立第三方。於往績記錄期間各年度／期間及直至最後實際可行日期，我們的董事及其各自的聯繫人或持有我們已發行股份總數5%以上的股東均未在五大供應商中持有任何權益。此外，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們與供應商概無發生任何重大糾紛。下表載列往績記錄期間各年度／期間我們五大供應商的詳情：

排名	供應商	採購金額 (人民幣千元)	佔總採購額的 百分比 (%)	所提供的產品／ 服務的主要類型	信貸期	付款方式	業務關係起始年份
截至2023年12月31日止年度							
1	供應商A ⁽¹⁾	1,129,773	21.4	覆銅板及半固化片	120天	電匯	1999年
2	供應商B ⁽²⁾	318,326	6.0	覆銅板及半固化片	60天	電匯	2006年
3	供應商C ⁽³⁾	299,432	5.7	覆銅板及半固化片	90至120天	電匯	2004年
4	供應商D ⁽⁴⁾	226,159	4.3	覆銅板及半固化片	90天	電匯	2016年
5	供應商E ⁽⁵⁾	205,359	3.9	覆銅板及半固化片	120至150天	電匯	2005年

排名	供應商	採購金額 (人民幣千元)	佔總採購額的 百分比 (%)	所提供的產品／ 服務的主要類型	信貸期	付款方式	業務關係起始年份
截至2024年12月31日止年度							
1	供應商A	2,056,814	21.1	覆銅板及半固化片	120天	電匯	1999年
2	供應商B	676,136	6.9	覆銅板及半固化片	60天	電匯	2006年
3	供應商C	510,194	5.2	覆銅板及半固化片	90至120天	電匯	2004年
4	供應商D	395,241	4.1	覆銅板及半固化片	90天	電匯	2016年
5	供應商F ⁽⁶⁾	297,741	3.1	生產設備	30天	電匯	2006年

排名	供應商	採購金額 (人民幣千元)	佔總採購額的 百分比 (%)	所提供的產品／ 服務的主要類型	信貸期	付款方式	業務關係起始年份
截至2025年12月31日止年度							
1	供應商A	3,155,711	22.3	覆銅板及半固化片	120天	電匯	1999年
2	供應商D	972,332	6.9	覆銅板及半固化片	90天	電匯	2016年
3	供應商B	723,257	5.1	覆銅板及半固化片	60天	電匯	2006年
4	供應商C	592,717	4.2	覆銅板及半固化片	90至120天	電匯	2004年
5	供應商F	528,654	3.7	生產設備	30天	電匯	2006年

排名	供應商	採購金額 (人民幣千元)	佔總採購額 的百分比 (%)	所提供的產品／ 服務的主要類型	信貸期	付款方式	業務關係 起始年份
截至2026年3月31日止三個月							
1	供應商A	1,109,438	21.2	覆銅板及半固化片	120天	電匯	1999年
2	供應商D	357,606	6.8	覆銅板及半固化片	90天	電匯	2016年
3	供應商B	307,236	5.9	覆銅板及半固化片	60天	電匯	2006年

業 務

排名	供應商	採購金額 (人民幣千元)	佔總採購額 的百分比 (%)	所提供的產品／ 服務的主要類型	信貸期	付款方式	業務關係 起始年份
4.....	供應商F	206,061	3.9	生產設備	30天	電匯	2006年
5.....	供應商C	199,093	3.8	覆銅板及半固化片	90至120天	電匯	2004年

附註：

- (1) 供應商A是中國內地的一家私營公司，為一家於台灣證券交易所上市的公眾公司的附屬公司，主要從事PCB用覆銅板及半固化片的生產。
- (2) 供應商B是中國內地的一家私營公司，為一家於東京證券交易所上市的公眾公司的附屬公司，主要從事PCB用覆銅板及其他電子電路材料的生產。
- (3) 供應商C是中國台灣的一家上市公司，主要從事PCB用覆銅板及半固化片的製造與銷售。其在台灣證券交易所上市。
- (4) 供應商D是中國內地的一家私營公司，為一家於韓國交易所上市的公眾公司的附屬公司，主要從事印刷電路板基材用覆銅板及半固化片的生產，其註冊資本約為人民幣1.4百萬元。
- (5) 供應商E是中國內地的一家私營公司，為一家於台灣證券交易所上市的公眾公司的附屬公司，主要從事印刷電路板基材用覆銅板及半固化片的生產。
- (6) 供應商F是德國羅德馬克的一家私營公司，營運歷史逾75年，擁有超過500名僱員，主要從事PCB生產用微機械精密機器及設備的開發與製造。

物流、倉儲及存貨管理

物流

我們委聘合資格獨立第三方物流供應商將產品運送至客戶指定地點。於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止的三個月，物流成本分別為人民幣34.3百萬元、人民幣53.7百萬元、人民幣69.2百萬元及人民幣19.3百萬元。據我們所知，於往績記錄期間各年度／期間及直至最後實際可行日期，我們的所有物流服務供應商均為獨立第三方。

存貨管理

我們定期執行存貨盤點並向管理層提交報告以供審閱。我們的存貨包括：(i)原材料、(ii)在產品及(iii)產成品。截至2023年、2024年、2025年12月31日及2026年3月31日，我們的存貨分別為人民幣1,548.4百萬元、人民幣2,274.3百萬元、人民幣4,091.7百萬元及人民幣4,913.4百萬元。於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月，我們的存貨周轉天數分別為87天、76天、91天及100天。詳情請參閱「財務資料－選定資產負債表項目－流動資產／負債－存貨」。原材料到貨時，我們按批次進行檢驗、記錄及分配，並及時記錄收貨、發料及轉庫作業。我們每半年進行一次全面存貨盤點，進行隨機抽查，並靈活調整存貨水平，以降低庫存過剩或陳舊化風險。根據交貨周期、需求模式及生產需求，我們為主要類別的原材料及零部件設定安全存貨量。我們的系統追蹤存貨存放時間及周轉率，針對滯銷或過時品項建立定期警示機制。生產優先使用臨近到期材料，視情況透過退貨、重做、折扣或報廢處理過時存貨。

業 務

與關稅有關的近期法規

關稅政策

在2025年年初，美國政府針對中國發起一系列關稅及貿易政策，導致中國作出反制措施。於往績記錄期間，美國對中國進口商品加徵的關稅最高達145%，而中國對美國進口商品加徵的關稅則最高達140%。截至最後實際可行日期，在出口目的地方面，就自中國內地及泰國出口的PCB而言，(i)在互惠關稅及芬太尼相關關稅於2026年2月終止後，美國徵收10%的基準關稅；及(ii)巴西徵收9%的進口關稅。我們出口至其他目的地的PCB通常無需繳納進口關稅。在採購方面，(i)進口原材料至中國內地須繳納4%的一般進口關稅稅率，而原產於美國的原材料則曾被徵收10%的互惠關稅；(ii)為泰國生產基地採購的原材料，我們泰國生產基地採購的原材料一般適用0%的泰國進口關稅稅率，包括(a)適用默認0%稅率的覆銅板；(b)符合泰國投資促進委員會（「BOI」）計劃資格的半固化片；及(c)憑東南亞國家聯盟（「東盟」）原產地證書享有資格的銅箔。

影響評估

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，董事認為，基於以下原因，近期中美兩國在關稅方面的緊張局勢並未對我們的業務營運及財務表現造成任何重大直接及／或間接影響，亦預期不會造成任何此類影響：

出口

來自美國的收入有限。我們來自美國的收入有限，包括銷售作商業用途的PCB以及用於客戶認證及測試的樣品及認證PCB，僅佔我們總收入的一小部分。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年3月31日止三個月，來自直接出口到美國的產品所得收入分別佔我們同期總收入約5.0%、4.8%、4.6%及3.2%。

關稅由我們的客戶承擔。就直接向美國銷售PCB而言，根據銷售協議中訂明的國際貿易條款，進口清關及關稅款項由我們的客戶負責。我們通常不處理或承擔該等交易的進口關稅，亦不對客戶將包含我們PCB的產成品出口到美國所徵收的貿易關稅負責。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們向美國銷售的PCB數量有限，因此並無因該等銷售而產生美國所徵收的關稅。

業 務

對我們的業務並無直接或間接不利影響。於往績紀錄期間及直至最後實際可行日期，我們的訂單數量、價格、客戶付款或物流安排並無發生任何重大不利變動，我們亦無因美國關稅的實施而收到客戶重新協商銷售協議、取消訂單或暫停交付產品的任何要求。此外，據我們所知，考慮到於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的主要客戶擁有全球多元化的銷售網絡，且不存在主要客戶僅向美國銷售終端產品的情況，美國關稅並未對我們客戶的業務及經營業績產生重大不利的間接影響。

進口

主要從中國內地採購。我們主要向中國內地的符合資格的供應商採購PCB生產所需的關鍵原材料，例如覆銅板、半固化片、銅箔、陽極銅、金鹽及乾膜，相關採購額分別佔我們於2023年、2024年及2025年以及截至2026年3月31日止三個月總採購額的84.2%、74.3%、77.5%及79.0%。

向海外非美國供應商作出有限採購。於往績記錄期間，我們向非美國海外供應商（主要為台灣、韓國、馬來西亞及新加坡的供應商）採購有限數量的原材料，包括覆銅板及銅箔，於往績記錄期間各年度／期間來自該等地區的相關採購額佔我們總採購額的10.0%以下。

有限採購美國原產原材料。我們進口的美國原產原材料佔我們採購的所有原材料的比例微不足道。於往績記錄期間各年度／期間，採購美國原產原材料的金額佔我們總採購額不足0.2%。

產生有限進口關稅。於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月，我們產生的中國進口關稅金額分別為人民幣0.2百萬元、人民幣1.0百萬元、人民幣2.6百萬元及人民幣0.3百萬元。

受美國出口管制及制裁的商業活動

事實背景

於往績記錄期間，我們與若干交易對手（「**相關交易對手**」）進行了交易，該等交易對手被列入美國限制名單，包括(i)美國商務部（「**美國商務部**」）維護的BIS實體清單，基於國家安全、外交政策、大規模殺傷性武器擴散或其他美國監管方面的考量，對受《出口管理條例》管制的物項的出口、再出口或轉讓，指定了須符合特定許可要求的外國實體；(ii)美國財政部外國資產控制辦公室（「**外國資產管理辦公室**」）維護的NS-CMIC清單，禁止美國人士購買或出售清單上的實體發行的公開交易證券或發行的證券衍生品；及(iii)美國國防部（「**美國國防部**」）維護的1260H清單，限制美國國防部與清單上的實體訂立合約，但並未施加更廣泛的商業往來限制。

業 務

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們有(i)九名客戶（「**相關BIS客戶**」），我們向其提供PCB）及一名供應商（「**相關BIS供應商**」），我們向其採購勞工服務）被列入BIS實體清單；(ii)三名供應商（「**相關CMIC供應商**」）被列入NS-CMIC清單，而我們向彼等採購通信服務（如電話費或寬頻費）；及(iii)另外七名供應商（「**相關1260H供應商**」），而我們向相關1260H供應商採購電訊服務，及另外一名客戶（「**相關1260H客戶**」）被新列入1260H清單，以及我們預期將繼續與該等實體進行交易。於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月，(i)來自九名**相關BIS客戶**的收入分別佔我們收入的4.0%、3.7%、3.7%及1.5%，而向**相關BIS供應商**採購的金額分別佔我們總採購額的零、0.003%、零及零；(ii)向三名**相關CMIC供應商**的採購分別佔我們同期總採購額的0.02%、0.01%、0.01%及0.01%；及(iii)來自一名新增的**相關1260H客戶**的收入分別佔我們同期收入的0.03%、0.03%、0.04%及0.03%，而向七名額外**相關1260H供應商**的採購額分別佔我們同期總採購額的0.004%、2.5%、0.7%及1.2%。

有關美國出口管制法的分析

就美國政府出口管制而言，根據我們美國出口管制法律顧問的意見，據董事所知及所悉，考慮到下列因素，董事認為於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團面臨的美國出口管制風險有限且本集團的營運符合適用美國出口管制法律及法規。

絕大部分產品不受《出口管理條例》規管 除經美國轉運至位於墨西哥客戶的產品外，我們的產品(i)並非原產於美國或位於美國；(ii)不經美國轉運或通過美國；(iii)不包含達到根據微量準則會觸發《出口管理條例》管轄權程度的原產於美國的組件、軟件或技術；(iv)並非原產於美國的「技術」或「軟件」的直接產品；或(v)並非使用本身為該等受管制美國技術或軟件的直接產品的任何成套工廠或主要組件所生產。據我們的美國出口管制法律顧問告知，我們的絕大部分產品不受《出口管理條例》規管，董事認為：(i)於往績記錄期間及直至最後實際可行日期向**相關BIS客戶**供應有關產品不涉及任何構成違反美國出口管制法律及法規的交易，及(ii)有關產品應用於或安裝於**相關BIS客戶**的產品中，其本身並不會觸發《出口管理條例》的管轄權，亦不構成違反美國出口管制法律。

受《出口管理條例》規管且歸類為EAR99的產品有限 於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團僅有若干經美國轉運至墨西哥客戶的PCB及嵌入芯片的PCB產品受《出口管理條例》規管。該等產品被歸類為EAR99。具體而言，EAR99為《出口管制條例》項下對受美國管轄、但未被商業管制清單（「**商業管制清單**」）中任何出口管制

業 務

分類號（「**ECCN**」）具體管制的物項的分類。雖然**EAR99**物項通常不需要出口許可證，但仍受到相關限制，不得供應予以下對象：(i)適用美國受限制人士清單上的大部分人士（「**受限制客戶**」）；(ii)受美國全面禁運的目的地；或(iii)被禁止的最終用途，包括軍事或大規模殺傷性武器計劃。如受**EAR**管制的物品將出口、轉口或轉讓作受限制最終用途或出口、轉口或轉讓予受限制最終用戶，則可能需要出口許可證。據我們的美國出口管制法法律顧問告知，董事認為，歸類為**EAR99**的產品受有限的美國出口管制規定所限，且在供應予未被列入任何適用美國受限制人士清單的非受限制客戶作民用最終用途，而非軍事或其他屬《出口管理條例》所禁止的最終用途時，通常不需要出口許可證。於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們概無**EAR99**產品供應予受限制客戶。

因此，鑒於上述情況，據我們的美國出口管制法法律顧問告知，董事認為，於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，本集團在所有重大方面已遵守《出口管制條例》，且《出口管制條例》及相關美國出口管制法律及法規並未對本集團的業務營運或財務表現造成重大影響。

有關美國制裁法的分析

就美國法律項下的主要制裁風險或次級受制裁活動而言，據董事經作出合理查詢後所知及所悉，並據我們的美國制裁法律顧問告知，考慮到下列因素，(i)我們與相關交易對手的業務活動並不涉及受制裁目標，亦不涉及滿足構成美國法律項下主要受制裁活動或次級受制裁活動的罪行的管轄權及實質要素所需的部門、行業或活動；及(ii)於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團的營運並無面臨重大制裁風險且遵守適用美國制裁法律：

未被列入任何美國制裁或受限制人士名單。截至最後實際可行日期，本公司或我們的任何附屬公司均未被列入任何美國制裁名單或受限制名單，且我們並未獲悉任何跡象顯示我們受到任何美國政府當局的制裁。本公司或我們的任何附屬公司均並非(i)受制裁目標；(ii)位於、成立於或居住於受美國全面制裁的國家；(iii)由位於受美國全面制裁的任何國家的實體擁有或控制，或由列入任何美國制裁名單或受限制名單的任何實體擁有或控制50%或以上；或(iv)因與受任何美國制裁的人士存在關係，或對該等人士擁有所有權、控制權或代理權而成為美國制裁的目標。

業 務

未從事主要受制裁活動或次級受制裁活動。儘管若干交易對手被列入NS-CMIC名單，但此制裁指定的限制範圍較為狹窄，僅禁止美國人士購買或出售清單上實體的公開交易證券，並不禁止向清單上實體銷售貨物或處理清單上實體的貨物。同樣地，將若干交易對手列入1260H清單，僅止於禁止美國國防部與該等實體訂立或延長合約，但並不禁止在此範圍以外的商業往來。因此，我們認為我們並未從事任何與該等交易對手往來有關的主要受制裁活動。我們亦未曾從事任何與該等交易對手往來有關的次級受制裁活動，原因為該等交易對手不受任何會使本公司面臨被實施美國次級制裁重大風險的美國制裁所規限。

非美國制裁

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，基於董事作出合理查詢後所深知，(i)本公司及其任何附屬公司均未受到歐盟、英國、聯合國或我們營運所在任何其他司法管轄區施加的任何制裁限制；及(ii)我們的客戶或供應商均未受到任何司法管轄區施加的任何重大制裁限制，以致影響我們的業務營運或產生重大合規風險。

內部控制措施

我們已(i)採納內部交易對手方篩選程序，根據我們經營業務所在司法管轄區及國際組織發出的適用制裁及出口管制名單對交易對手方的交易進行評估；(ii)針對新客戶及供應商接納實施內部批核程序，包括在完成制裁及貿易管制篩查後由指定人員簽署確認；(iii)建立規程，定期收集並動態更新相關部門發佈的制裁名單、制裁政策及相關公告，以便及時識別適用貿易限制的變動；及(iv)建立內部報告渠道，以及時向我們的地緣政治事務管理委員會報告篩選結果及潛在風險，從而促進及時決策及反應式風險管理。

結論

鑒於上述情況，據我們的美國出口管制法及制裁法律顧問告知，董事認為於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，(i)本集團已於所有重大方面遵守適用美國出口管制法律及法規以及適用制裁法律；(ii)海外制裁、出口管制、貿易限制並未且預計亦不會對我們的業務營運或財務表現產生任何重大直接或間接影響；及(iii)本集團的活動並未涉及新上市申請人指南第4.4章所述的重大制裁風險。

業 務

美國境外投資限制

於2024年10月28日，美國財政部頒佈《關於美國在特定國家安全技術和產品領域的投資規定》（「《對外投資安全計劃》最終規則」），以限制美國人士及受美國控制實體的投資。最終規則於2025年1月2日生效，並針對美國人士及美國控制的實體涉及「關注國家」（包括中國）的投資，若該等國家的人士或實體從事半導體及微電子、量子信息技術或人工智能等特定行業（「涵蓋活動」）則為「涵蓋外國人士」。《對外投資安全計劃》最終規則對美國人士的投資（「涵蓋交易」）施加禁止或申報要求，包括股權收購、特定債務融資、合資企業，以及作為非美國人士集合投資基金有限合夥人的特定投資。據我們有關《對外投資安全計劃》最終規則的法律顧問告知，基於以下考量，董事認為我們並非「涵蓋外國人士」且我們未從事任何對外投資規則所指的「涵蓋活動」：(i) 我們並不開發、生產或促成半導體、量子計算或人工智能等受該對外投資規則限制的特定行業的技術或產品；(ii) 我們主要從事PCB的生產，並不屬於特定高科技產業；及(iii) 我們並不提供可支持美國政府所界定受限制技術製造能力或研發服務。因此，據我們有關美國外國投資法的法律顧問告知，鑒於我們並非「涵蓋外國人士」，且並無從事任何「涵蓋活動」，董事認為：(i) 美國人士於[編纂]中認購H股，及(ii) 美國人士於[編纂]後在香港聯交所[編纂]H股，均不構成「對外投資規則」下的涵蓋交易，亦不因此受到任何禁止或承擔任何通知義務。鑒於上文所述，董事認為，最終規則將不會對本公司的業務營運、財務表現、[編纂]或投資前景造成重大不利影響。

信息安全與數據私隱保護

我們遵守不斷演進的數據安全和私隱保護法律法規，包括《中華人民共和國網絡安全法》、《中華人民共和國數據安全法》、《中華人民共和國個人信息保護法》及泰國《2019年個人資料保護法》（佛曆2562年）（「PDPA」）。

數據收集、使用及傳輸

我們主要向企業客戶提供產品，且我們不會透過產品收集、存儲或處理用戶個人或敏感信息。我們在經營過程中會收集、存儲和處理商業及交易數據，包括聯絡資料、企業資料及與客戶和供應商之間的交易數據，以及生產製造、庫存及其他運營統

業 務

計數據。我們收集的個人資料僅限於以下類別及用途：(i)用於業務溝通的客戶及供應商聯絡資料；(ii)現場訪客的訪客資料；及(iii)用於人力資源管理的僱員個人資料。針對直接向個人收集的個人資料（包括訪客資料及僱員資料），我們根據隱私權政策取得同意。針對間接收集的涉及客戶及供應商聯絡人的個人資料，提供方有義務於向我們提供資料前事先取得相關人士的有效同意。我們所收集的資料（包括個人資料）主要儲存於昆山、黃石及常州的實體伺服器機房。除法院或行政命令強制要求，否則我們不會向任何第三方共享或傳輸所收集的數據。

跨境數據傳輸

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，為了與海外客戶及供應商溝通，並根據勞動法規進行跨境人力資源管理，我們將若干個人資料（包括僱員資料、聯絡詳情及通訊記錄）傳輸至中國境外（主要為泰國）的接收方，反之亦然。有關傳輸規模有限，且為上述目的而言屬必要。我們已為該等傳輸擬備同意表格，並藉此取得相關僱員的有效同意。針對從中國傳輸出的數據，根據《促進和規範數據跨境流動規定》並據中國數據合規顧問所告知，有關傳輸符合豁免條件，因此獲豁免遵守(i)申請境外數據傳輸安全評估；(ii)就境外傳輸個人資料訂立標準合約；或(iii)取得境外傳輸個人資料認證的規定。

信息安全保障措施

我們設立的內部政策及一系列的程序包括：(i)**網絡安全**：我們通過入侵檢測與防禦工具及終端防護軟件保護系統安全；我們實施定期監控、漏洞評估及滲透測試，以識別並降低潛在風險；(ii)**數據保護與私隱**：我們已制定規範，涵蓋數據分類、加密技術應用、基於角色的訪問控制、備份存儲及定時數據備份；敏感信息訪問權限嚴格限制於授權人員，由IT部門集中管理權限；(iii)**安全覆核與測試**：我們對IT系統進行監控與定期覆核。我們定期執行漏洞掃描、滲透測試及安全演練；發現的系統弱點將通過糾正措施和系統升級修復；(iv)**員工培訓與意識提升**：我們定期為員工提供培訓課程，強化其對信息安全責任及最佳實踐的意識；員工須遵守保密義務及內部安全政策；(v)**災難恢復與業務持續性**：我們建立災難恢復與業務持續性框架，以最大限度減少運營中斷，包括日常系統健康檢查、備份完整性驗證及定期恢復流程測試；及(vi)**數據存儲**

業 務

及銷毀：我們根據政策刪除數據：我們相應存儲法律規定最短存儲期限的數據，而就法律未規定存儲期限的數據而言，我們根據業務策略確定存儲期限。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未發生任何客戶機密數據洩露或任何其他可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大不利影響的客戶數據相關事件。據中國數據合規顧問C&F Data及泰國數據合規顧問W&W Partners所告知，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團在中國及泰國的營運在所有重大方面已分別遵守中國及泰國關於數據安全與隱私的適用法律及法規。

競爭

我們經營的PCB行業競爭激烈，屬技術與資本雙密集型行業。隨著生成式AI大模型持續迭代、全球智算中心與數據通訊基建加速建設，以及新能源和智能網聯汽車產業快速滲透，全球頭部客戶對PCB產品的高性能、高信賴性和高頻高速表現要求日趨嚴苛。我們深耕高端PCB領域多年，主要與全球具備高端PCB研發及規模量產能力的頭部廠商，尤其是高速網絡交換機及路由器、AI服務器、HPC及智能汽車等核心應用領域的高端PCB製造商競爭。當前高端PCB市場的核心競爭集中於前沿技術研發、穩定高良率的大批量生產能力、頭部客戶資源、全球化供應鏈管理及客製化需求快速響應能力。進一步詳情，請參閱「行業概覽」。

環境、社會及管治

我們致力加強ESG管治框架、提升重要ESG指標的表現，並實施各項ESG倡議。

ESG風險與機遇管理

我們的重要ESG議題包括應對氣候變化、資源效率、排放物及廢水管理、產品質量管理與信息安全、人力資源管理、職業健康與安全、可持續供應鏈管理、企業社會責任與公益、商業道德與反腐敗等。我們已將氣候風險納入全組織風險管理流程。我們每年評估氣候相關風險和機遇，據此制定並實施行動方案，並向董事會匯報。

業 務

ESG治理

為實現科學、系統、規範的ESG體系管理，董事會建立了由戰略與ESG委員會、戰略規劃小組及ESG工作小組組成的ESG管理架構，制定委員會工作細則《戰略與ESG委員會工作細則》，根據可持續發展政策變化、公司經營發展、持續完善可持續發展管理範圍，將相關原則融入到日常運作中。

董事會成員的專業背景與能力建設

董事會成員具備電子製造、企業管理、法律合規及財務管理等背景。一名董事具備多年產業園區環境管理及綠色生產的實務經驗，能為董事會提供環境治理方面的專業視角。董事在風險控制與合規管理方面的專長，亦有助本集團履行社會責任。

管理與執行機構

董事會。董事會牽頭設立董事會戰略與ESG委員會並制定董事會戰略與ESG委員會工作細則，是ESG事宜的最高責任及決策機構，負責審議ESG策略、政策、目標及重點工作事宜。

董事會戰略與ESG委員會。委員會由三名以上董事組成；委員由董事長、二分之一以上獨立董事或三分之一以上全體董事提名，並由董事會選舉產生。主任委員由公司董事長擔任，負責主持委員會工作。委員會對公司長期發展戰略、重大投資決策以及ESG相關工作負責，包括對ESG相關目標、規劃、策略、風險等重大事項進行研究，制定、審閱及更新ESG相關政策，對ESG執行情況追蹤檢視，以及審閱ESG報告及其他ESG相關披露。戰略與ESG委員會對董事會負責，委員會根據需要召開會議，提案提交董事會審議決定。該委員會下設戰略規劃小組和ESG工作小組。

戰略規劃小組及ESG工作小組。兩個小組分別由公司董事長及公司總經理領導，根據實際工作需要由相關高級管理人員組成，分別負責日常管理及公司戰略事務以及

業 務

ESG相關日常工作。兩個小組協同支持戰略與ESG委員會制定策略與ESG目標、推動實施過程、為解決執行問題提供專業協助與事務保障，並使相關工作有序落地。

環境保護

我們致力於完善環境管理體系建設，持續優化資源利用，加強對污染防治與控制，持續降低污染物排放。於往績記錄期間，我們主要的生產基地獲得了ISO 14001環境管理體系認證，且未因違反環境法律法規而受到環境主管部門的任何重大行政處罰。我們已制定合理的環境管理目標，承諾自2024年起確保廢氣、廢水及廢棄物處置合規率維持100%，並計劃以2024年為基準年，於2030年實現取水強度降低5%及可再生能源使用佔比達70%的目標。

應對氣候變化

策略

參照香港聯合交易所的新氣候規定及《國際財務報告準則S2號—氣候相關披露》，我們已識別、評估及管理可能影響我們業務及資產的實體風險、轉型風險及氣候機遇。針對極端天氣及氣溫上升等實體風險，我們透過實施緊急應變計劃、加強設備運維監控；面對碳中和政策與市場低碳需求帶來的轉型風險，本集團推行光伏發電、餘熱回收及節能技術升級，並在產品全生命週期貫徹低碳設計及碳足跡評估。同時，我們把握氣候機遇，提升資源效率以降低長期營運成本，並透過開發符合市場預期的低碳產品，強化本集團的綠色競爭優勢。我們結合氣候相關風險和機遇評估結果，實施減緩與適應措施。我們通過優化PCB流程設定提升裁板利用率並簡化工序，結合強化能效監控與循環經濟應用，我們五個生產基地中有四個獲評國家級或省級綠色工廠。2025年，本集團光伏發電總量達12,323.36兆瓦時，並配合綠電證書核銷與光伏擴容規劃，優化能源結構。我們積極推動資源循環與價值鏈減排，致力實現覆銅板中銅箔100%使用再生材料。我們發揮企業影響力，督促上游供應商開展溫室氣體盤查並披露碳資料。

業 務

指標與目標

我們已通過科學基礎減量目標倡議(SBTi)核查，相較於2024年基準年，到2030年將範圍1和範圍2溫室氣體(GHG)排放量減少42%，並將範圍3 GHG排放量減少25%。下表載列我們截至2025年12月31日止三個年度的GHG排放情況：

指標 ^[2]	單位	截至12月31日止年度		
		2023年	2024年	2025年
GHG排放				
範圍1 GHG排放	tCO ₂ e	15,047.3	16,347.9	28,334.7 ⁽³⁾
範圍2 GHG排放	tCO ₂ e	278,469.3	355,748.9	457,213.3
範圍3 GHG排放 ⁽¹⁾	tCO ₂ e	649,890.4	451,914.0	699,426.7
GHG排放密度				
範圍1和範圍2 GHG排放密度	tCO ₂ e／人民幣百萬元收入	32.8	27.9	25.6
範圍1、2及3 GHG排放密度	tCO ₂ e／人民幣百萬元收入	105.5	61.8	62.5

附註：

- (1) 範圍3包括類別1購買的商品和服務、類別2資本貨物、類別3燃料和能源相關活動（不包括在範圍1或範圍2中）、類別4上游運輸配送、類別5運營產生的廢棄物、類別6商務旅行、類別7員工通勤、類別8上游租賃資產、類別9下游運輸配送、類別12售出產品的報廢處理。
- (2) 本集團溫室氣體排放的統計與獨立第三方機構核查均以完整年度進行，故並無提供截至2026年3月31日止三個月的相關定量數據。
- (3) 2025年範圍1 GHG排放強度有所上升，主要由於數據通訊領域PCB產量增加，其需採用等離子體清洗工藝。該工藝使用的四氟化碳具有較高的全球變暖潛能值，從而導致直接排放強度相應上升。

資源效率

我們響應構建資源節約型社會的號召、建設低碳企業，並遵守適用法律法規。我們通過技術升級和精細化管理，力求降低能源消耗。我們致力於落實節水改進方案、減少原材料使用，從而提升整體資源利用效率。於往績記錄期間，我們持續改善資源利用效率。綜合能源消耗密度（噸標準煤／人民幣百萬元收入）由2023年的7.49降至2025年的5.93，並進一步降至截至2026年3月31日止三個月的5.33。同期取水密度（千噸／人民幣百萬元收入）由0.48降至0.45，並進一步降至截至2026年3月31日止三個月的0.39。可再生能源發電量由2023年的3,900.45兆瓦時增至2025年的12,323.36兆瓦時，並進一步增至截至2026年3月31日止三個月的3,409.86兆瓦時。

業 務

排放物及廢水管理

我們已根據適用法律法規建立內部管理程序，並實施排污許可證制度。我們根據各廠房的排放許可要求，通過配套先進的廢水深度處理、廢水回用系統、廢氣處理設施及生產廢棄物回收設施，配置專業環境管理團隊，符合當地要求。於往績記錄期間，我們在所有主要指標方面均取得改善。廢氣排放密度（百萬立方米／人民幣百萬元收入）由2023年的3.12降至2025年的1.80，並進一步降至截至2026年3月31日止三個月的1.50。廢水排放密度（千噸／人民幣百萬元收入）由2023年的0.43降至2025年的0.37，並進一步降至截至2026年3月31日止三個月的0.32。廢棄物排放密度由每人民幣百萬元收入6.09噸降至5.13噸，並進一步降至截至2026年3月31日止三個月的5.08噸，且100%有害廢棄物均依照法規處置。針對一般工業固廢等無害廢棄物，我們實行分類、儲存和處理；針對可回收廢棄物，我們委託合資格的回收機構進行分類回收，以助廢物減量化、資源化和循環利用；針對不可回收的生活垃圾，我們委託環衛所收集處理，以最大程度減少對環境的影響。此外，我們備存有害廢棄物的記錄，並將其存放於設有危險廢棄物警示標誌，並採取防風、防雨、防曬、防滲、防盜等防護措施的指定區域，確保安全合規的處理流程。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未發生廢氣或廢水污染物超標、違規排放或廢棄物處置不合規事件。

人力資源管理

我們遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國職業病防治法》及其他相關法律法規，制定實施《人力資源管理規則》、《職業健康管制程序》，切實保障員工的合法權益與職業健康。我們秉持平等公正與多元包容原則，禁止任何形式的歧視與騷擾，為員工提供具市場競爭力的薪酬激勵及培訓體系。2025年及截至2026年3月31日止三個月，我們的員工月平均流失率分別為2.9%及2.3%，其中非生產人員的月平均流失率分別為0.9%及0.9%。截至2025年12月31日和2026年3月31日，中高層管理人員女性佔比分別為26.4%和25.5%。此外，我們的主要生產運營單位均已通過ISO 45001職業健康安全管理体系認證。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未發生任何重大職業健康與安全違規事件或死亡事故。

業 務

可持續供應鏈管理

我們已根據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規制定《採購競標管理辦法》及《供應商管制程序》。我們實行覆蓋供應商開發、評估、選擇、考核及退出的管理機制，同時通過定期ESG合規調查、來料檢驗及質量追溯體系，監測供應商在商業道德與環境責任方面的履行情況。

企業社會責任與公益

我們履行社會責任，推動公益志願活動。我們組織員工志願者參與社區服務，包括開展消防安全知識宣傳以提升居民安全知識；走訪福利院並參與助殘活動；及與昆山市水利局合作進行河道清潔活動。

與同行企業比較

下表呈列基於公開披露的2025年ESG報告，對本集團與所選取的中國三家主要上市同行企業公司的關鍵ESG指標的比較分析。根據分析，本集團在關鍵ESG指標的表現與主要上市同業公司報告的範圍基本一致。

ESG指標	單位	本集團 (2025年表現)	所選同行 企業表現(範圍)
廢氣排放強度 ⁽¹⁾	百萬立方米／ 人民幣百萬元收入	1.80	1.52
廢水排放強度	噸／人民幣百萬元收入	369.49	349.74-506.93
有害廢棄物強度	噸／人民幣百萬元收入	3.83	5.32-6.90
無害廢棄物強度	噸／人民幣百萬元收入	1.31	0.83-1.67
新鮮水取水強度	噸／人民幣百萬元收入	452.58	381.28-512.44
總能耗強度	噸標準煤／ 人民幣百萬元收入	5.93	5.48-10.08
溫室氣體排放強度 (範圍1及範圍2)	噸二氧化碳當量／ 人民幣百萬元收入	25.63	19.57-44.40
溫室氣體排放強度 (範圍1、範圍2及範圍3 ⁽¹⁾)	噸二氧化碳當量／ 人民幣百萬元收入	62.55	109.63
中高層管理人員女性佔比	%	26.42	15.08-18.65

附註：

(1) 僅一家同行企業披露了廢氣排放量及範圍3溫室氣體數據。

業 務

合規管理

在往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們不存在因違反環境保護或安全生產相關中國法律法規而被處以重大行政處罰的情況，且我們已遵守泰國環境相關法律。截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度及截至2026年3月31日止三個月，我們的環境合規成本分別為人民幣39.8百萬元、人民幣50.0百萬元、人民幣117.5百萬元及人民幣24.8百萬元。2025年合規成本大幅增加主要由於為在泰國建設新生產廠房而投資廢水處理設施。

員工

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們大部分員工常駐中國。下表載列截至2026年3月31日按職能劃分的員工明細。

職能	人數	佔總人數百分比
生產	12,380	75.0%
研發及技術 ⁽¹⁾	3,177	19.2%
銷售及市場推廣	145	0.9%
財務	107	0.6%
行政	703	4.3%
總計	16,512	100.0%

附註：

(1) 包括研發、工程、生產技術及生產管理人員。

我們與員工簽訂標準僱傭協議，涵蓋保密條款、知識產權、僱傭條款、商業道德及競業限制等事宜。除了網站及校園招聘外，我們亦已實施內部推薦機制。我們定期為員工提供內部培訓計劃。

社會保險及住房公積金

我們參與多項政府法定員工福利計劃，包括社會保險計劃，即養老、醫療、失業、工傷及生育保險計劃，以及住房公積金。

未合規背景及原因

於往績記錄期間，鑒於部分員工不願繳納嚴格按其薪金比例計算的金額，我們未按中國相關法律法規要求為員工全額繳納社會保險和住房公積金。於2023年、2024年、2025年以及截至2026年3月31日止三個月，我們於社會保險及住房公積金供款差

業 務

額於同期分別為人民幣33.6百萬元、人民幣38.0百萬元、人民幣61.6百萬元及人民幣18.7百萬元，分別佔我們同期收入0.4%、0.3%、0.3%及0.3%。

潛在法律後果

根據中國相關法律法規，如果我們將來未能按照中國相關法律和法規繳納社會保險費，我們可能會被要求在規定期限內支付未繳納的社會保險費，滯納金按未繳金額的每日0.05%計算，自社會保險供款到期之日起累計。如果未在規定期限內支付，主管部門可能會處以逾期金額一至三倍的罰款。如果未能全額支付住房公積金，相關住房公積金管理中心可能會要求我們在規定期限內支付未繳金額。如果未在規定期限內繳付，可向中國法院申請強制執行。

經考慮：(i)根據相關部門（據我們的中國法律顧問告知，為確認與我們社會保險及住房公積金事宜有關的主管機關）發出的書面確認，於往績記錄期間，我們並無因社會保險或住房公積金事宜而受到任何行政處罰或法院強制執行行動；(ii)根據《國家稅務總局辦公廳關於穩妥有序做好社會保險費徵管有關工作的通知》，不得自行組織對以前年度欠費進行清繳；根據《國家稅務總局關於實施進一步支持和服務民營經濟發展若干措施的通知》，不得對包括民營企業在內的繳費人以前年度欠費開展集中清繳。《國務院辦公廳關於印發〈降低社會保險費率綜合方案〉的通知》要求妥善處理歷史欠費問題。在徵收體制改革過程中，不得對企業欠費進行集中清繳，不得採取任何增加小微企業實際繳費負擔的做法；(iii)根據我們的中國法律顧問就我們及我們的國內附屬公司所在中國內地地區的相關主管社會保險當局及住房公積金管理中心（據中國法律顧問告知，為確認與我們相關的社會保險及住房公積金事宜的主管機關）進行的匿名電話諮詢，除非僱員投訴，否則該等當局通常不會主動進行審計或要求補繳；(iv)我們並無收到相關當局就僱員對社會保險或住房公積金供款提出的重大異議或投訴發出的任何通知；及(v)我們已承諾，倘主管當局要求我們糾正任何不合規情況，我們將履行相關義

業 務

務，我們的中國法律顧問認為，倘現行中國政策及執行或監督慣例並無重大變動，且並無集體僱員投訴或訴訟或仲裁，我們於往績記錄期間被相關主管當局處罰或要求補繳的風險很低。

根據於2025年9月1日生效的《最高人民法院關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(二)》，用人單位與勞動者約定或者勞動者承諾無需為勞動者繳納社會保險費，人民法院應當認定該約定或者承諾無效。用人單位未依法為勞動者繳納社會保險費，勞動者依據《勞動合同法》第三十八條第(3)項規定要求解除勞動合同並主張經濟補償的，人民法院應予支持。根據對中國法律法規的理解，該條文一般適用於僱主完全未有為僱員繳納社會保險供款的情況。在僱主已作出該等供款但供款基數不足的情況下，法院支持相關主張的可能性較低。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們及我們的中國附屬公司概無接獲相關機關就僱員對社會保險供款及住房公積金提出的重大投訴發出的任何通知，亦無被相關機關處以任何罰款。因此，本公司認為該詮釋不會對本集團的營運或財務狀況產生重大不利影響。

因此，於往績記錄期間，我們並未就社會保險及住房公積金供款差額作出撥備。於往績記錄期間，我們因社會保險供款差額可能面臨的最高罰款於同期分別為人民幣89.7百萬元、人民幣94.1百萬元、人民幣159.6百萬元及人民幣46.9百萬元，佔我們同期收入約1.0%、0.7%、0.8%及0.8%。倘若有關主管部門向相關法院申請強制執行，於往績記錄期間，我們因住房公積金供款差額可能面臨的潛在最高執行金額於同期為人民幣3.7百萬元、人民幣6.7百萬元、人民幣8.4百萬元及人民幣3.1百萬元，佔我們同期收入約0.04%、0.05%、0.04%及0.05%。

防止再次發生的內部控制措施

我們擬透過以下措施加強合規框架：(i) **人力資源管理政策**：我們將優化人力資源政策，要求依照適用法律及法規供款；(ii) **員工溝通**：我們將加強員工溝通，解釋參加社會保險及住房公積金計劃的重要性；及(iii) **培訓及意識提升**：我們將推行培訓計劃，

業 務

以加強其對合規義務的認識。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未發生任何重大勞資糾紛、罷工、抗議或為我們的業務招聘員工時遇到任何困難。

保險

我們的保單主要包括財產一切險、產品責任保險及業務中斷保險。我們相信現有投保範圍就業務而言屬充足，並符合我們經營業務所在國家／地區的行業標準。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無任何重大保險索償。請參閱「風險因素－與我們的業務及行業有關的風險－我們的保險覆蓋範圍可能不足以覆蓋所有損失或客戶的潛在索賠」。

跨境集團內交易

概覽及轉讓定價評估

於我們的日常業務過程中，若干集團實體在司法管轄區（包括中國內地、香港、新加坡及泰國）進行集團內交易。於往績記錄期間，我們的集團內交易包括(i)製成品的集團內買賣；(ii)集團內提供銷售代理服務；(iii)集團內合約加工安排；及(iv)其他金額較小的、非主要集團內交易。於2023年、2024年及2025年，我們的集團內交易金額分別為人民幣6,505.0百萬元、人民幣10,368.5百萬元及人民幣13,268.1百萬元。參與跨境集團內交易的主要實體為(i)製造實體，例如本公司、黃石滬士、滬利微電、滬士泰國、江蘇勝偉策；及(ii)銷售實體，例如滬士國際及WUS Singapore。

我們根據經濟合作暨發展組織（「**OECD**」）發佈的《跨國企業與稅務機關轉讓定價指南》（「**OECD指南**」）進行轉讓定價審查，該等指南與我們經營所在司法管轄區（包括中國內地、香港、新加坡及泰國）的轉讓定價法律及法規大體一致。我們亦遵守中國轉讓定價法規及實施條例，並遵守相關司法管轄區的一般轉讓定價常規。我們已委聘獨立轉讓定價顧問（「**轉讓定價顧問**」）對我們於往績記錄期間的集團內交易進行審閱。轉讓定價顧問審閱了由我們提供的資料，並評估轉讓定價安排是否符合公平交易原則，以及有關安排是否會產生任何重大轉讓定價風險。

業 務

集團內製成品買賣的分析

於往績記錄期間，我們若干實體從事PCB製成品的集團內買賣。主要交易包括製造實體向銷售實體進行的銷售。轉讓定價顧問採用交易淨利潤法（「交易淨利潤法」），並針對可比分銷商進行了基準研究，其結論為上述相關實體的利潤率位於可比基準的四分位區間內，因此可以認為該等交易的轉讓定價安排符合公平交易原則。

集團內提供銷售代理服務的分析

於往績記錄期間，WUS Singapore向本公司、滬士國際及黃石滬士提供銷售代理服務。作為回報，WUS Singapore收取銷售佣金。請參閱「一 銷售及營銷 – 銷售模式 – 銷售代理」。轉讓定價顧問已進行了基準測試以評估佣金率，得出的結論是佣金率位於可比基準的四分位區間內，因此可以認為該等交易的轉讓定價安排符合公平交易原則。

集團內合約加工安排的分析

於往績記錄期間，若干製造實體之間進行產品加工交易。轉讓定價顧問採用交易淨利潤法進行了基準測試，其結論為相關實體的利潤率位於可比基準的四分位區間內，因此該等交易的轉讓定價安排符合公平交易原則。

其他非主要集團內交易的分析

集團內銷售、支援服務及租賃安排。於往績記錄期間，我們若干實體從事其他金額較小、非主要的集團內交易，包括(i)集團內銷售固定資產、經加工部件及原材料，以支持生產及經營需要；(ii)集團內支援服務安排，包括(a)經營支援服務、(b)物業管理服務、(c)廢水處理服務；及(iii)集團內租賃安排。轉讓定價顧問已審閱該等交易並認為該類交易轉讓定價安排主要參照市場價格或與第三方的業務常規；且由於該類交易主要在境內實體之間進行，發生重大轉讓定價調整並繳納額外稅款的風險較低。

集團內融資安排。於往績記錄期間，若干實體訂立集團內融資安排，包括境內及跨境融資安排。轉讓定價顧問認為相關交易的定價大多參照當時市場利率，或在稅務上已參照外部借款利率的推算利息收入繳納稅款；因此，該等交易在稅務上可合理地被視為符合公平交易原則，發生重大轉讓定價調整的風險較低。

業 務

結論及稅務影響

基於上述分析，誠如轉讓定價顧問所告知，董事認為(i)本集團的集團內交易已訂立合理的轉讓定價安排；(ii)集團內交易在所有重大方面均符合OECD指南項下的公平交易原則，而我們的轉讓定價安排並無引起需要重大調整的合規問題；及(iii)我們的轉讓定價安排應不會引致重大轉讓定價風險，被進行重大轉讓定價調整的風險較低。根據聯席保薦人進行的盡職調查，並無任何事項引起其注意，以致其不同意董事就轉讓定價安排發表的意見。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，(i)我們並未收到任何司法管轄區的任何相關稅務機關發出的要求我們就集團內定價安排繳納額外稅項的任何通知或要求；(ii)據董事所深知，中國內地、香港、新加坡或泰國的稅務機關均未對我們的集團內交易進行任何審計、開展調查或提出質疑；及(iii)我們並無因轉讓定價安排受到任何處罰。誠如前述轉讓定價顧問的審閱結論，董事認為，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團集團內交易的轉讓定價安排在所有重大方面符合OECD轉讓定價指南及相關稅收管轄區與轉讓定價適用的法律及法規的公平交易原則。管理層將繼續定期監察本集團的轉讓定價安排，並審閱我們集團內定價政策的合理性。請參閱「風險因素－與我們的業務及行業有關的風險－我們的轉讓定價安排可能會受到我們經營所在司法管轄區相關稅務機關的審查」。

物業

自有物業

土地

截至2026年3月31日，我們擁有並佔用九幅與中國生產及業務運營相關的的土地的土地使用權，總土地面積約750,571平方米，以及10幅主要與泰國生產及業務運營相關的的土地的土地使用權，總土地面積約203,144.8平方米，主要用於製造、商業及辦公用途。截至2026年3月31日，我們已為所有自有及佔用的土地取得全部土地使用權證。

房屋

截至2026年3月31日，我們分別於中國擁有22處與生產經營相關的樓宇及單位及於泰國擁有10處樓宇及單位，於中國的總建築面積約為694,457平方米及於泰國的總建築面積約為177,840平方米，主要用於製造、商業及辦公用途。截至2026年3月31日，我們已就我們擁有的所有房屋取得物業權證。

業 務

租賃物業

截至2026年3月31日，我們於中國租賃七處與生產經營相關的物業，總建築面積約為2,019平方米。截至2026年3月31日，我們與泰國三名出租人簽訂租賃協議，當中涵蓋總建築面積約11,083平方米的物業，有關物業供我們的僱員居住。對於我們於中國內地租賃的前述物業，出租人已取得相關業權證書及／或同意、授權或批准，該等證書及／或同意、授權或批准賦予出租人權利出租該等物業。我們的租約通常為期一年。物業租賃協議須向中國住房和城鄉建設部相關地方分支機構辦理登記。截至最後實際可行日期，我們尚未完成上述七項位於中國的租賃物業的租賃登記。未能完成租賃協議登記主要由於難以獲得若干出租人的配合，原因為登記程序須由雙方共同提交文件。根據中國相關法律法規，有關政府部門可能要求我們在規定期限內完成相關租賃協議登記，否則我們可能就每份未登記租約面臨人民幣1,000元以上人民幣10,000元以下的罰款。因此，因未能登記上述租賃協議產生的最高罰款總額將約為人民幣70.0千元。

據中國法律顧問告知，租賃協議未登記不影響其法律效力。我們亦將透過以下方式加強內部控制措施：(i)加強與出租人溝通及聯繫，共同提交租賃協議登記所需文件；及(ii)監控登記進度，並主動與出租人合作，以推進向住房主管部門申報。請參閱「風險因素－與我們的業務及行業有關的風險－某些租賃物業的使用可能會受到第三方或政府部門的質疑，從而可能導致我們的業務營運受影響。」。

物業估值

截至最後實際可行日期，構成物業活動一部分的單一物業權益的賬面值不超過我們總資產的1%或以上，且我們並無任何單一物業的賬面值達到或超過我們總資產的15%。因此，根據上市規則第5.01A條，我們毋須於本文件內載列任何估值報告。根據香港法例第32L章《公司（豁免公司及文件遵從條文）公告》第6(2)條，本文件獲豁免遵守《公司（清盤及雜項條文）條例》第342(1)(b)條中有關《公司（清盤及雜項條文）條例》附表三第34(2)段的規定，該規定要求就我們於土地或樓宇的所有權益提供估值報告。

於往績記錄期間，物業銷售及租賃業務產生一小部分收入，根據上市規則第5.01A(1)條構成本集團物業活動的一部分。我們持作出售及租賃的物業主要包括我們

業 務

在湖北省黃石市開發的員工宿舍，主要目的是支持員工留任及促進員工隊伍穩定。其次，該等物業亦有極少部分出售予第三方。截至2023年、2024年、2025年12月31日及2026年3月31日，我們持作出售的已竣工物業的賬面值分別為人民幣148.1百萬元、人民幣108.9百萬元、人民幣102.0百萬元及零，而我們截至同日的開發中物業的賬面值分別為人民幣52.8百萬元、人民幣52.9百萬元、人民幣52.2百萬元及零。誠如於2026年3月7日及3月21日所宣佈，我們已透過將於黃石供應鏈所持的100%股權出售予黃石聯虹房地產開發有限公司（「黃石聯虹」，一家由吳禮淦家族控制的關聯方），出售我們的物業銷售及租賃業務，代價約為人民幣9.7百萬元，預期此項交易不會對我們的業務、經營業績及財務狀況造成任何重大不利影響。出售代價乃根據獨立第三方評估機構發出的估值報告所載的評估價值而釐定。該項出售已於2026年3月20日完成。

牌照、批准及許可

截至最後實際可行日期，我們已自相關政府部門取得就我們於中國及海外的業務營運而言屬重大的所有必要牌照、批准及許可。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們在重續牌照、批准及許可方面並未遇到任何重大困難，且目前預計在重續時不會有任何重大困難。

獎項及殊榮

下表載列於往績記錄期間及直至最後實際可行日期我們獲得的主要獎項及殊榮。

獎項／榮譽	獲獎年份	頒獎機構
國家級綠色工廠.....	2025年、2023年	工業和信息化部辦公廳
全球供應商管理 (GSM) 年度最佳供應商 ...	2025年	全球領先的數字通訊技術公司
最佳質量供應商.....	2024年	全球領先的汽車一級供應商
中國電子電路行業百強企業.....	2025年、2024年	中國電子電路行業協會

法律訴訟及合規事宜

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並未涉及我們相信將會對我們的業務、經營業績、財務狀況或聲譽或合規狀況造成重大不利影響的實際或未決法律程序、仲裁或行政程序（包括任何破除或財產接管程序）。於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並未涉及任何可能單獨或合計對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響的導致罰款、強制行動或其他處罰的重大或系統性不合規事件。

業 務

內部監控及風險管理

董事會全面負責監督風險管理政策的制定與實施，涵蓋運營效率、財務報告完整性、遵守法律法規、信息安全、人力資源及反腐敗等關鍵領域。

財務報告風險管理

我們已建立會計政策、標準化程序及獨立監督機制。財務部門負責編製並審核管理賬目與財務報表。我們另設審計委員會監督財務報告流程，並評估相關內部控制的有效性。

合規風險管理

我們的法律與合規團隊負責跟蹤監管動態、審查與客戶、供應商及其他交易對手方的合同，並獲取必要的審批或許可。我們對業務夥伴進行盡職調查，定期為員工提供合規培訓，並建立內部舉報渠道。

人力資源風險管理

我們的人力資源風險管理體系涵蓋招聘、培訓、績效評估、勞動法合規及道德標準遵循等。我們持續提供技術培訓，以提升員工能力與意識。我們定期進行績效考核並根據績效結果調整薪酬，同時定期更新政策以反映勞動法規變化。

反腐敗風險管理

我們已建立反腐敗管理體系，設置多個舉報渠道。員工須遵守行為準則，並定期接受反腐敗及道德標準培訓，我們亦對擔任敏感職位的員工進行額外提醒。我們要求業務夥伴在入職流程中簽署誠信廉潔協議，並進行盡職調查及評估以強化道德規範。我們對任何形式的不當行為或違反商業道德的行為採取零容忍政策，並設有保密舉報機制。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無涉及任何與腐敗、賄賂或欺詐相關的法律訴訟。